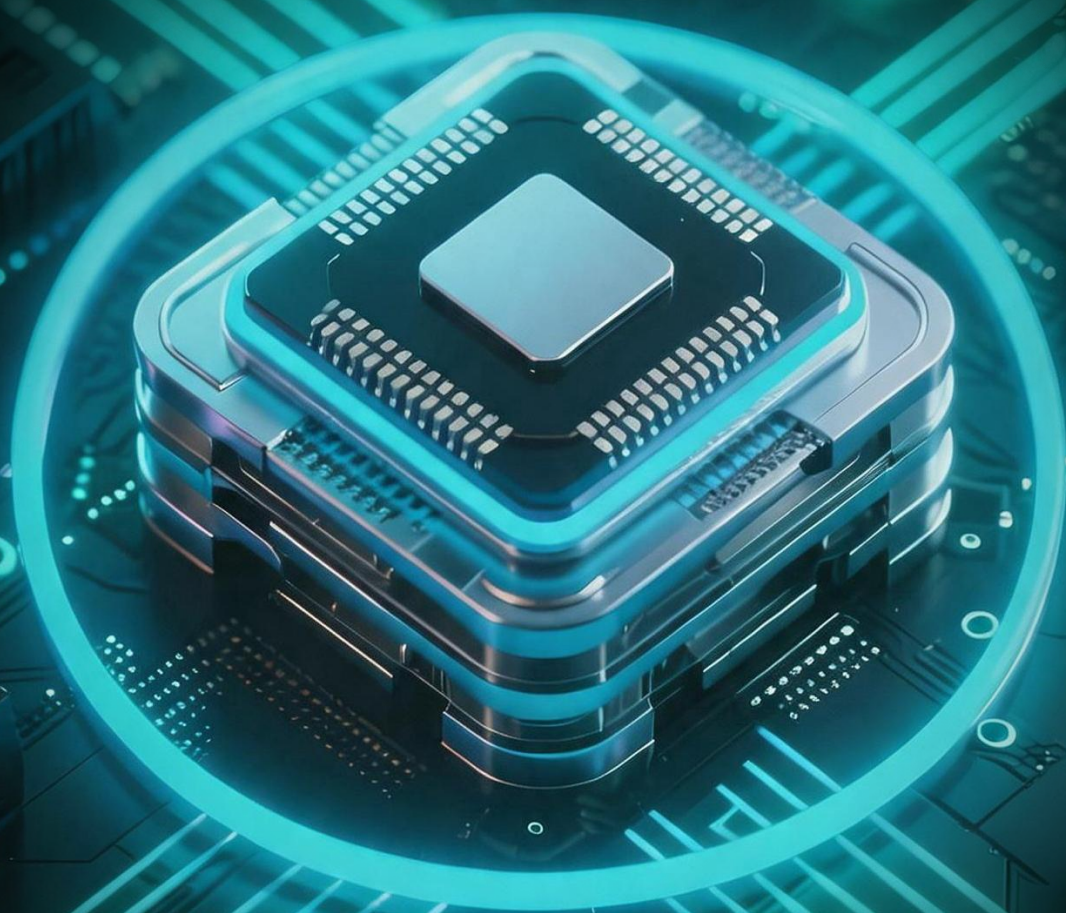




体系韧性·战略主动 2026中国半导体产业白皮书

2026年8月

前言	3
----	---

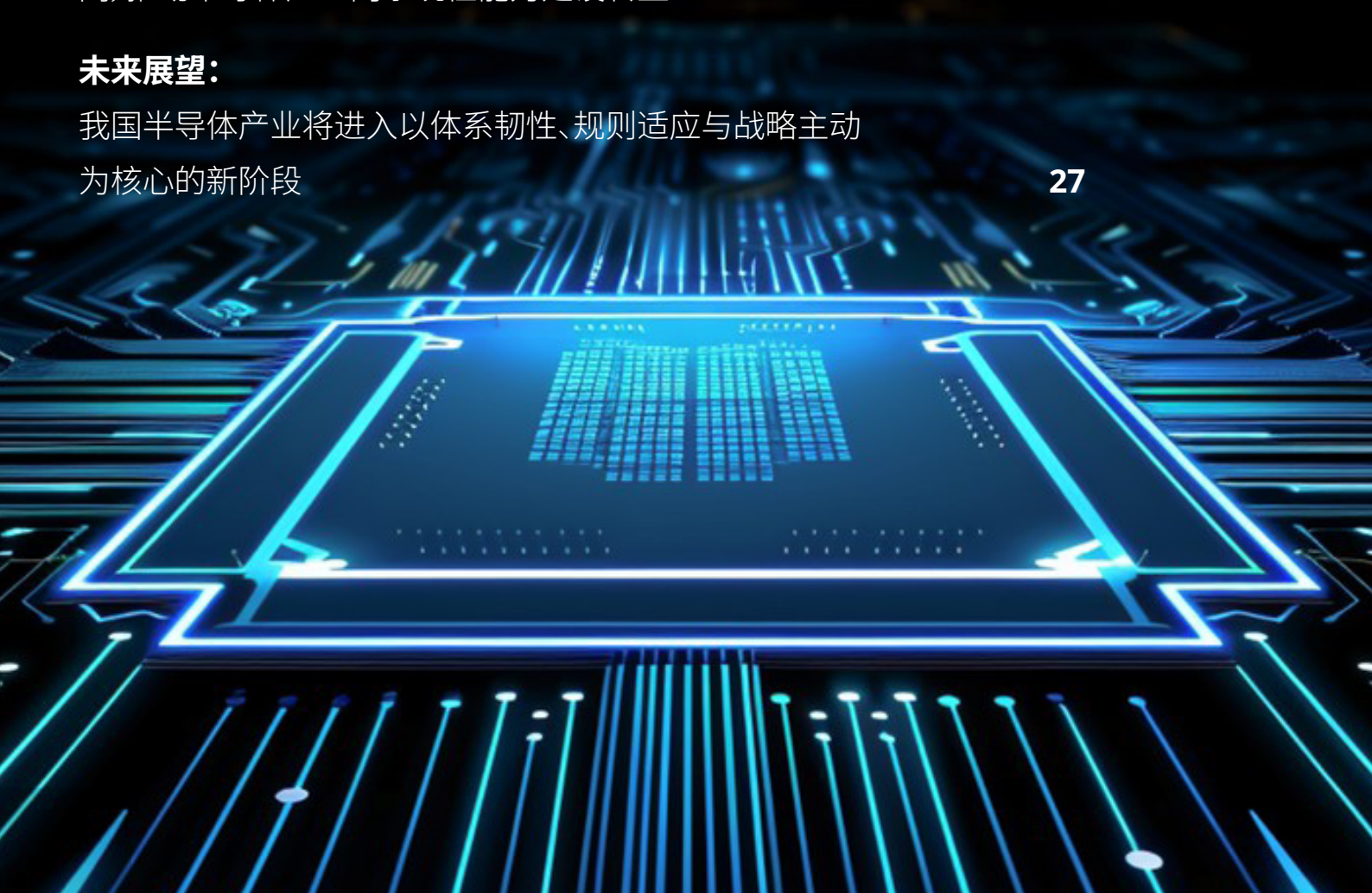
第一章：	
产业跨越：我国半导体产业在规模、技术、和生态等多维度实现快速发展	4

第二章：	
资本回归理性，半导体产业加速分化	10

第三章：	
供应链韧性：全链条受控演进，多节点分布式架构，实现系统性去风险与全球韧性	18

第四章：	
政策引领：国内政策体系聚焦自主可控、高端突破与全链协同，推动半导体产业向系统性能力建设转型	21

未来展望：	
我国半导体产业将进入以体系韧性、规则适应与战略主动为核心的新阶段	27



摘要

当前，全球半导体产业正处于深度调整与结构性重塑阶段。地缘政治环境变化、供应链安全议题以及人工智能算力需求的爆发，正在从根本上改写行业的发展逻辑。在此背景下，中国半导体产业正由以规模扩张为主的粗放发展模式，迈向以全产业链受控与系统级能力提升为特征的新阶段。本次报告从产业跨越、资本重构、供应链韧性、政策引领四大维度，系统性梳理行业发展现状、核心驱动因素及未来趋势。

一、我国半导体产业在规模、技术、和生态等多维度实现快速发展

我国半导体产业告别单一规模扩张，进入多维度协同发展的新阶段。市场规模稳步增长，产业重心向高附加值环节延伸，全链条协同能力成为竞争关键。

- **芯片设计：芯片设计行业保持较快增长的同时，集中度进一步加强。**2025年中国芯片设计产业销售额达到8357亿元，行业在保持较快增长的同时，头部企业集中度持续提升，EDA工具国产化进程加快，行业正由分散竞争向“强而优”格局演化。
- **半导体材料：在规模基础上向高端制程延伸，突破关键环节“卡点”。**中国半导体材料市场规模持续增长，国产替代由成熟制程向先进制程关键材料延伸，第三代半导体材料成为新增增长曲线，高壁垒领域攻关成为重点。
- **半导体封测：先进封装成增长核心引擎。**2025年中国封测市场规模突破2753亿元，先进封装占比持续提升，预计2030年市场规模将达4271亿元，产业价值重心持续上移。
- **半导体设备：中低端设备与配套环节**

具备成长空间，高端装备自主创新仍需持续投入。中国已成为全球最大半导体设备市场，2025年市场规模达559亿美元，中低端设备国产化加速，高端装备仍需长期攻关。

- **半导体生产：争取在成熟制程的规模化统治，并在先进制程领域进行差异化突围。**国内晶圆制造能力持续扩张，成熟制程实现规模化统治，先进制程受限环境下，企业通过工艺优化和差异化路线寻求突破。

二、资本回归理性，半导体产业加速分化

- **IPO审核趋严推动半导体资本资源向高壁垒、高质量企业集中。**A股上市更加重视硬科技属性、技术壁垒和盈利可验证性，A+H上市成为重要融资补充，存储龙头资本化提速进一步强化国产存储的持续投入能力。
- **行业并购正在从局部补强走向提升集中度和产业链控制力。**当前半导体并购仍以中小规模交易为主，横向整合侧重产品和研发资源补强，纵向整合侧重打通上下游、增强供应链协同。
- **半导体投融资热度维持高位，资本仍偏好早中期项目。**机构延续“投早、

投小、投潜力”策略，通过提前布局细分赛道获取未来成长和并购退出机会。

- **存储产业的投资逻辑正从短期盈利转向长期能力建设。**评估重点应放在良率改善、产品迭代能力、亏损可修复性、现金流支撑能力，以及AI驱动下的未来需求卡位。

三、全链条受控演进，多节点分布式架构，实现系统性去风险与全球韧性

行业发展逻辑由效率优先转向安全可控，国产替代向全链条延伸，企业通过多元布局提升供应链抗风险能力。

- **从单点国产化向全链条受控转型，形成全产业链受控，并推动全产业链技术升级。**国产替代由制造端向上游设备、材料延伸，企业强化上下游协同，构建全链条受控体系，系统性降低中断风险。
- **供应链构建正向多节点分布式布局演进。**企业通过多区域布局、双总部架构等方式，分散地缘政治风险，平衡本土安全与全球经营，构建更具韧性的供应链体系。

四、国内政策体系聚焦自主可控、高端突破与全链协同，推动半导体产业向系统能力建设转型

政策由普惠支持向“卡脖子”环节定向攻坚，构建多维度支撑体系。

- **顶层设计：国家半导体产业政策顶层设计定向支持“卡脖子”环节攻关。**

国家通过纲领性文件，明确产业发展方向，资源向EDA、光刻机等底层基础环节集中，引导企业突破关键技术瓶颈。

- **资金层面：国家财税政策由普惠式支持转向围绕关键技术突破的研发投入激励。**

通过长期资金支持、税收优惠、专项补贴等方式，降低企业研发与生产负担，支持关键领域技术攻关。

- **产业链：提升产业链稳定性与自主保障能力，**增强对外部不确定性的抵御能力。政策推动全产业链协同联动，完善质量认证体系，强化关键资源管理，提升产业整体抗冲击能力。

- **资本市场：资本政策强化企业整合能力与全周期融资支持。**通过并购重组机制优化、完善股权融资体系、创新债券市场等方式，构建覆盖企业全生命周期的资本支持体系。

- **地方协同：地方政府通过差异化措施推动半导体产业落地与集聚。**各地依托本地产业基础，通过产业园区建设、专项补贴、人才政策等方式，推动产业落地与集群发展，形成多层次、多区域协同格局。

展望未来，我国半导体产业将迈入以体系韧性、规则适应与战略主动为核心的全新发展阶段，产业竞争不再局限于单一技术或规模比拼，而是转向全链条协同、资源整合与长期治理的综合能力较量。未来行业将从追赶式发展向内生能力塑造转型，短期聚焦成熟制程规模化与关键环节国产替代筑牢发展根基，中期加快全产业链协同布局并在先进封装、AI芯片等领域实现差异化突破，长期持续完善产业生态与治理体系，稳步提升全球产业话语权，在复杂多变的国际格局中牢牢把握发展主动权，实现产业高质量、可持续稳健发展。

前言

当前，全球半导体产业正处于深度调整与结构性重塑的阶段。一方面，地缘政治环境变化叠加供应链安全议题，使“自主可控”与“韧性建设”成为各主要经济体半导体产业发展的重要议题；另一方面，人工智能的快速发展显著提升了对高性能算力的需求，并持续重塑芯片架构、产品形态及产业价值分布。

在政策定向引领与AI算力爆发的双重驱动下，中国半导体产业正由以规模扩

张为主的发展阶段，逐步迈向以全产业链受控与系统级能力提升为特征的新阶段。产业发展重心正从单一环节的产能与技术突破，转向覆盖设计、制造、封装测试及关键设备与材料的全链条协同优化。

这一转型过程中，产业运行逻辑正在发生系统性变化。资本配置更加聚焦关键环节与核心能力建设，产业组织方式由分散竞争转向协同整合，供应链布局由

效率导向逐步转向安全与可控并重。同时，AI技术不仅带来需求侧的结构性增长，也在供给侧推动芯片设计方法、制造工艺及系统架构的持续演进，成为影响行业长期发展的关键变量。

基于此，本文旨在从产业演进与结构变化的视角出发，系统梳理中国半导体产业在新阶段所呈现的核心发展特征，并将其归纳为五大支柱，以提供对行业趋势的结构化理解与参考框架。

图：中国半导体产业发展“四大支柱”



第一章 产业跨越：我国半导体产业在规模、技术、和生态等多维度实现快速发展

我国半导体产业正处于由“规模驱动”向“规模、技术与生态协同发展”转型的关键阶段。整体来看，我国半导体产业不仅在市场规模上持续扩张，同时在关键技术能力与产业生态体系方面也取得阶段性进展，呈现出多维度协同提升的特征。

这一发展趋势并非局限于单一环节，而是已在半导体价值链的各个关键节点中同步体现。从上游材料与设备，到中游设计与制造，再到下游封装测试，各环节在不同发展阶段上均呈现出能力提升、结构优化与国产替代推进等共同特征。此外，产业链各环节之间的联动关系正在得到不断加强，这使产业发展从“分环节推进”逐步走向“全链条协同演进”，从而构成了当前中国半导体产业最核心的发展主线。

基于此，本章从半导体价值链视角出发，系统梳理中国半导体产业在芯片设计、半导体材料、封装测试、半导体设备及晶圆制造等关键环节的发展现状与趋势，重点分析各环节在规模、结构与技术层面的演进特征，从而呈现产业在全链条范围内的协同发展路径。

1.1. 芯片设计：芯片设计行业保持较快增长的同时，集中度进一步加强

芯片设计是半导体产业链中市场活力最强、创新最为密集的环节之一，也是我国半导体产业中起步较早、市场化程度较高、增长速度较快的核心领域。随着人工智能、汽车电子、工业控制、物联网、智能终端等下游需求持续扩张，我国芯片设计行业继续保持较快增长，并逐步从过去数量扩张主导的粗放发展模式，转向头部企业做强、国产工具补链强链的高质量发展阶段。

（一）产业规模持续扩大，中国已成为全球芯片设计的重要增长极

从规模来看，2025年中国芯片设计产业销售额达到8,357亿元人民币，同比增长29.4%，重回高速增长区间。同时，中国芯片设计产业占全球集成电路市场的比例有所上升，在全球约4,300亿美元的设计市场中占比超过25%。这一市场规模不仅体现出中国在全球设计分工体系中的重要地位，也反映出本土市场需求对设计产业的强支撑作用。

（二）头部企业集中化趋势明显，行业由“小而散”向“强而优”演化

在规模扩张的同时，行业结构正在发生

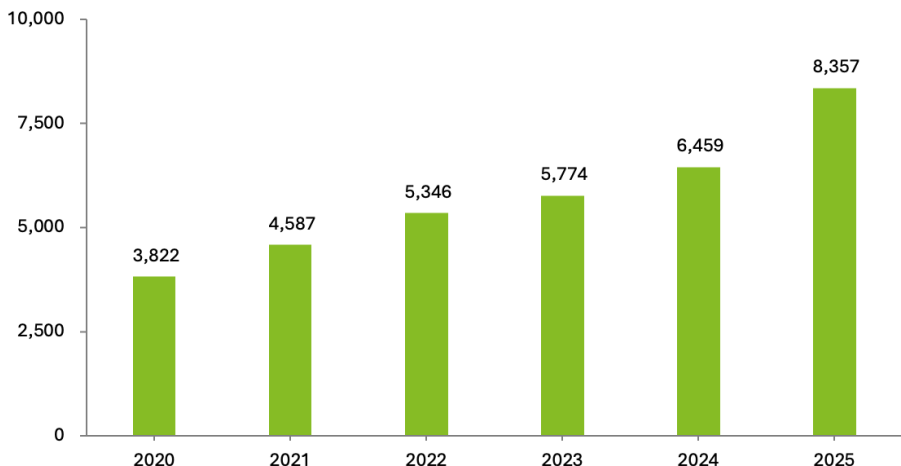
深刻变化，集中度持续提升成为最显著的趋势之一。2025年，销售额过亿企业数量持续增加，超过了800家。一方面，随着技术复杂度提升与研发投入门槛提高，单点产品导向的小型设计企业面临更大的生存与竞争压力；另一方面，资本市场与产业资源逐步向具备平台能力、产品矩阵与客户覆盖能力的头部企业集中，推动行业由“分散竞争”向“头部主导”的格局演进。销售额过亿企业数量的持续增加，表明行业整体正在进入规模化与专业化并存的发展阶段，但资源配置效率与技术积累能力正在向少数企业集中。

（三）EDA国产化渗透持续提升，设计工具自主可控能力加快形成

EDA（电子设计自动化）工具是芯片设计的底层基础软件，也是影响产业链安全性和技术独立性的关键环节。近年来，在政策引导、供应链安全需求和本土客户导入的共同推动下，国内芯片设计公司正加快导入国产EDA工具，华大九天、概伦电子等企业在部分关键环节取得积极进展。当前，国产EDA的推进重点已从局部工具替代逐步延伸至更完整的设计流程覆盖，尤其在物理验证、时序分析以及成熟制程全流程设计等领域，自主化水平持续提升。对于大量聚焦成熟制程、特色工艺和特定应用场景的设计企业而言，国产EDA工具已具备更强的实用性和可替代性。与此同时，国产EDA厂商通过与晶圆厂、IP供应商、设计服务企业及高校科研机构的协同联动，正在构建更完善的工具—工艺—IP适配体系。

不过也应看到，在先进工艺支持、全流程平台能力、复杂SoC设计验证和国际生态兼容性等方面，国产EDA与国际领先厂商仍存在差距。未来，EDA国产化的关键不只是单点工具突破，更在于形成覆盖算法、数据库、流程平台、工艺协同和客户验证的系统能力。总体看，EDA国产化已从“政策推动期”进入“应用渗透期”，正成为我国芯片设计行业提升自主创新能力的重要支撑。

图：中国芯片设计产业销售额（亿元）



数据来源：中国半导体行业协会集成电路设计分会

1.2. 半导体材料：在规模基础上向高端制程延伸，突破关键环节“卡点”

芯片设计是半导体产业链中市场活力最强、创新最为密集的环节之一，也是我国半导体产业中起步较早、市场化程度较高、增长速度较快的核心领域。随着人工智能、汽车电子、工业控制、物联网、智能终端等下游需求持续扩张，我国芯片设计行业继续保持较快增长，并逐步从过去数量扩张主导的粗放发展模式，转向头部企业做强、国产工具补链强链的高质量发展阶段。

（一）市场规模稳步扩大，材料产业基础持续夯实

从规模层面来看，中国半导体材料产业已具备坚实基础。2025年市场规模达到156亿美元，占全球市场约21%。这一体量不仅反映出国内晶圆制造与封装需求的持续扩张，也意味着中国已成为全球材料体系中不可忽视的需求与应用中心。在这一阶段，材料产业的核心功能在于支撑制造规模扩张，即通过国产替代实现供应稳定性与成本优化。

（二）国产替代向先进制程关键材料延伸，高壁垒领域攻关成为重点

当前，我国半导体材料国产替代已不再局限于成熟制程和通用性材料，而是加快向先进制程关键材料延伸。政策支持重点也从原先覆盖面较广的通用材料布局，逐步聚焦于EUV光刻胶核心单体、先进制程用抛光液（CMP）、高纯前驱体、先进薄膜材料等高技术壁垒领域。这表明我国材料产业的发展重点，已经由“补齐短板”逐步转向“突破卡点”。

先进制程材料的难点不仅在于研发门槛高，更在于其验证周期长、对工艺适配要求极高、客户导入标准极为严苛。因此，材料企业必须与晶圆制造企业、设备厂商及工艺研发平台建立更深层次协

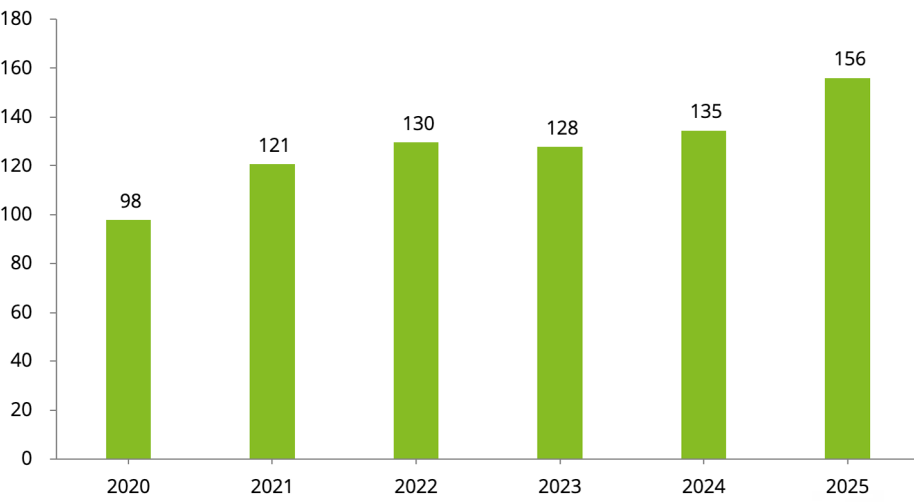
同，才能实现从实验室成果到量产供应的有效转化。可以预见，未来半导体材料领域的竞争，将更多表现为“综合体系能力”的竞争，即研发能力、纯化能力、质量控制能力、验证支持能力和长期供货能力的全面竞争。

（三）第三代半导体材料需求快速上升，成为新增长曲线的重要来源

在传统硅基材料稳步发展的同时，以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为代表的第三代半导体材料需求正快速增长，成为我国半导体材料产业的重要新增量。当前，8英寸碳化硅衬底已实现技术突破并开始量产，标志着我国在大尺寸SiC衬底领域迈出关键一步。相较于6英寸产品，8英寸衬底更有助于提升单片产出效率、摊薄制造成本，并推动功率器件在新能源汽车、光伏储能、工业变频等领域进一步普及。

与此同时，氮化镓材料在高频、高功率和高效率应用场景中的优势不断显现，随着其在低空经济、新能源和6G通信等新兴场景中的应用深化，上游外延片、衬底、前驱体及相关材料需求有望呈现指数级增长。总体而言，第三代半导体材料正推动我国材料产业从“跟随式发展”向“场景驱动型创新”转变，为行业构建新的竞争优势提供了重要机会。

图：中国半导体材料市场规模（亿美元）



数据来源：SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International)

1.3. 半导体封测：先进封装成增长核心引擎

封装测试位于半导体产业链后道环节，是连接晶圆制造与终端应用的重要桥梁。长期以来，我国在全球封测产业中占据较高比重，具备较好的产业基础和制造配套能力。当前，随着算力芯片、高带宽存储、智能终端和汽车电子等应用持续升级，封测行业正由传统规模扩张阶段迈向结构升级阶段，先进封装逐步成为行业增长的核心引擎。

（一）行业规模持续增长，中国封测市场仍具较大发展潜力

2025年，中国半导体封装测试行业规模突破2753亿元。展望未来，至2030年，中国半导体封装测试行业规模有望达到4271亿元，显示出较强的中长期增长韧性。中国封测产业增长的主要驱动因素包括：一是国内集成电路设计和制造能力提升带来的本土订单增长；二是AI、高性能计算、汽车电子、工业控制等新应用推动封装复杂度持续上升；三是全球供应链区域化趋势下，国内封测环节在成本、效率和配套能力方面仍具较强竞争力。特别是在先进制程受限背景下，封装技术的重要性进一步提升，成为延续系统性能提升、实现异构集成和缩短产品上市周期的重要抓手。

（二）产品结构加速向先进封装转型，产业价值重心持续上移

从产品结构来看，传统封装形式如DIP、SOP等仍占据一定市场空间，但其整体占比持续下降，行业增长动能明显弱于先进封装。相比之下，Chiplet、SiP、TSV等先进封装技术正在成为市场增长主力。2025年，先进封装市场规模占比已达39%，预计到2030年将提升至48%以上，表明我国封测产业的价值重心正在快速上移。

这一变化的本质在于，先进封装已逐步演变为系统性能优化的重要技术平台。尤其在AI芯片、HBM配套、异构集成、系统级模块和高密度互联等场景中，先进封装对于提高带宽、降低功耗、缩短

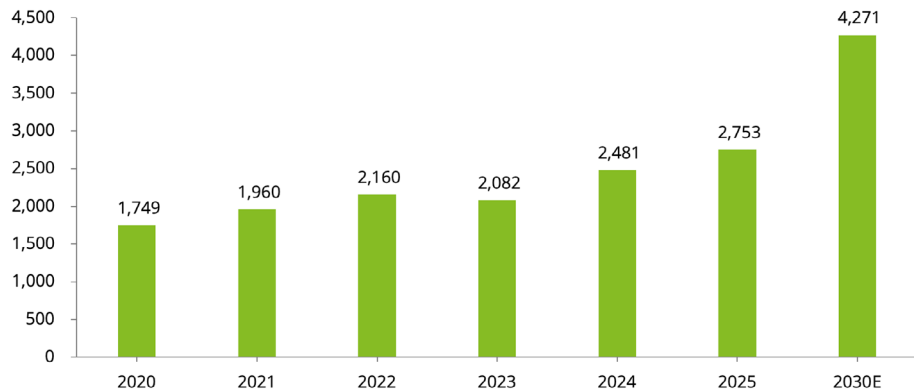
信号路径、提升集成度具有明显优势。对于中国半导体产业而言，在先进制程设备获取受限的情况下，发展先进封装不仅具备现实紧迫性，也具备战略替代意义，即通过封装创新部分弥补制程代差，在系统层面实现性能跃升。

（三）封装材料国产化提速，但高端基板仍是关键短板

伴随先进封装快速发展，封装材料的重要性持续上升，特别是封装基板、塑封料、键合丝、引线框架、底部填充材料等关键配套材料，直接影响封装产品的可靠性和成本结构。总体来看，我国半导体封装材料国产化进程正在加快，但在高端封装基板领域仍存在明显差距。

不过，随着深南电路、兴森科技等企业在ABF载板量产、FCBGA项目等方面取得突破，国产厂商正加速追赶，预计到2028年相关国产化率有望提升至40%。这意味着，未来几年将是我国高端封装基板国产替代的关键窗口期。谁能够率先突破高多层、高精度布线、高可靠性和大尺寸基板制造能力，谁就有望在先进封装浪潮中占据更有利位置。

图：中国半导体封装测试行业规模（亿元）



数据来源：芯德半导体、金元证券研究所

1.4. 半导体设备：中低端设备与配套环节具备成长空间，高端装备自主创新仍需持续投入

半导体设备是支撑芯片制造能力的核心生产资料，也是我国半导体产业链中技术壁垒最高、国产化难度最大的关键环节之一。近年来，在下游晶圆厂扩产、国产替代加快和政策扶持强化的背景下，我国半导体设备产业实现较快发展，市场空间持续扩大，国产设备在部分细分领域取得明显进展。但整体来看，行业仍呈现中低端突破较快、高端核心环节受限明显的格局，高端装备的自主创新仍需长期投入和持续攻关。

（一）我国已成为全球最大半导体设备市场，需求牵引作用突出

我国已成为全球半导体设备最大的需求方。2025年，中国半导体设备市场规模攀升至559亿美元，全球市场份额提升至42%，并已连续六年保持全球最大单一市场地位。庞大的设备需求规模，为国产设备企业提供了难得的试错空间、验证平台和商业化机会，是我国设备产业发展的重要基础优势。

一方面，晶圆制造、存储、功率半导体和先进封装等项目持续建设，为前道和后道设备带来稳定需求；另一方面，国际环境变化使得下游客户更重视本土设备导入，推动国产设备从辅助设备、检测设备、清洗设备逐步向刻蚀、薄膜沉

积、量测等关键环节延伸。可以说，超大规模市场需求是我国半导体设备国产化最现实、最重要的驱动力之一。

（二）国产化率进入核心爬坡阶段，但部分高端设备仍明显薄弱

从国产替代进展看，国内半导体设备国产化率预计将从2025年的25%提升至35%，高于此前约30%的市场预期，表明我国设备国产化已经进入加速推进的核心爬坡阶段。尤其在清洗设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备、检测量测设备以及部分后道设备领域，国内企业的技术成熟度和市场认可度正在稳步提升。

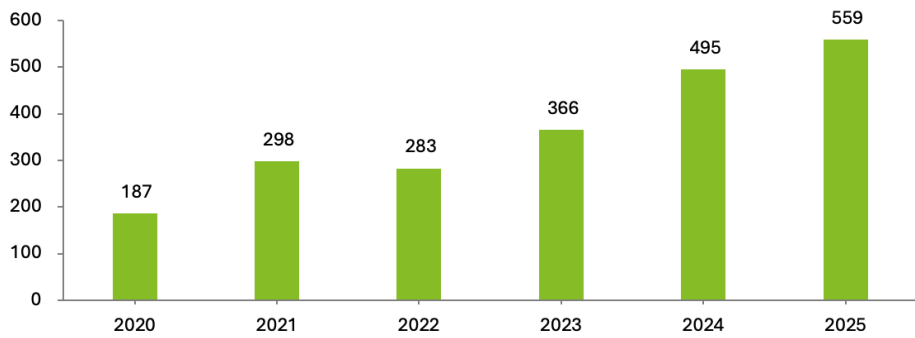
不过也必须清醒认识到，在若干关键高端装备上，国产化率依然较低，特别是

在高端光刻相关设备、离子注入机以及部分极高精度量测设备等领域，仍与国际领先水平存在显著差距。这些设备往往具有多学科交叉、系统复杂度高、零部件协同要求严苛等特点，其突破不能依赖短期突击，而需要长期研发积累、产业链配套完善和稳定的市场验证环境。因此，未来半导体设备国产化的重点，不仅是扩大已有优势环节的市场份额，更在于围绕高端短板建立更强的底层技术能力与产业协同机制。

（三）先进封装设备需求快速上升，成为设备产业新增长极

在先进制程持续受限的背景下，国内产业链对通过封装技术提升系统性能的路径愈发重视，由此带动Chiplet、HBM相关封装设备需求显著增长。先进封装设备虽然同样具备较高技术门槛，但在部分“次高端”设备领域，国内厂商更有机会率先实现突破并扩大市场份额。具体来看，随着先进封装渗透率提升，国产划片机、键合机、减薄机以及相关检测、贴装、热处理设备需求快速增加。该领域一方面具备现实市场空间，另一方面能够在一定程度上形成绕过先进制程限制、通过系统集成提升算力表现的产业替代路径，因此被视为我国半导体设备产业未来数年最具成长性的细分赛道之一。

图：中国半导体设备市场规模（亿美元）



数据来源：SEMI

1.5. 半导体生产：争取在成熟制程的规模化统治，并在先进制程领域进行差异化突围

晶圆制造是半导体产业链中资金密集度最高、技术复杂度最强、战略属性最突出的核心环节。当前，全球晶圆代工市场竞争格局总体呈现“先进制程高度集中、成熟制程供给重塑、特色工艺加速分化”的趋势。对于我国而言，考虑到高端设备和先进工艺仍面临外部限制，现实可行的发展路径是：一方面在成熟制程领域做大规模、做强供应、提升全球影响力；另一方面在先进制程、特色工艺和重点应用方向上实施差异化突围，逐步提升高端制造能力。

（一）产业规模稳步增长，晶圆制造能力持续扩张

2025年，国内晶圆代工市场规模达到1997亿元，预计2030年将达到3142亿元。近年来，随着国内晶圆厂持续扩产、地方产业政策支持强化以及下游本土需求增长，我国晶圆制造能力实现了较快提升，尤其在28nm及以上成熟制程、模拟工艺、功率器件、嵌入式非易失存储、显示驱动和CIS相关制造环节上形成了较强承接能力。

制造能力扩张不仅体现在产能数字上，更体现在本土客户协同能力和工艺平台逐步完善上。面对不断增长的国产芯片流片和量产需求，国内晶圆厂在产线扩建、工艺平台优化、供应链本地化和客户服务响应等方面均持续提升，为我国集成电路产业整体韧性增强提供了支撑。

（二）行业竞争由单一先进制程比拼转向多领域差异化竞争

从国际竞争格局看，台积电凭借先进制程

和顶级客户资源，仍在高端代工市场保持显著领先优势。但与此同时，中国晶圆制造企业如中芯国际、华虹、晶合集成等，正借助国产替代、政策补贴、本土需求承接的综合优势，在成熟制程、特色工艺和细分赛道中加快突破。

具体而言，国内厂商难以在短期内全面复制国际龙头在3nm、2nm等最先进节点上的能力，但可以在CIS、功率半导体、显示驱动芯片、嵌入式MCU、模拟器件、车规芯片等细分方向形成更具现实竞争力的制造平台。这种竞争逻辑表明，行业发展已不再是单一维度的“谁的制程更先进”，而是转向“谁更能匹配应用需求、谁更能构建特色工艺壁垒、谁更能形成稳定客户生态”的多维竞争。

（三）市场需求多元化为本土晶圆厂带来结构性机会

当前，半导体市场需求呈现显著分化和多元化趋势。不同晶圆厂的增长驱动力并不完全一致：有的依靠AI算力相关芯片实现高端需求承接，有的受益于消费电子复

苏，有的则由汽车电子与工业控制驱动增长，还有的更多受益于本土替代和供应链安全需求。这种需求结构变化，使行业竞争不再局限于少数先进节点，而是扩展为多技术路线、多产品类别、多场景协同的综合竞争。

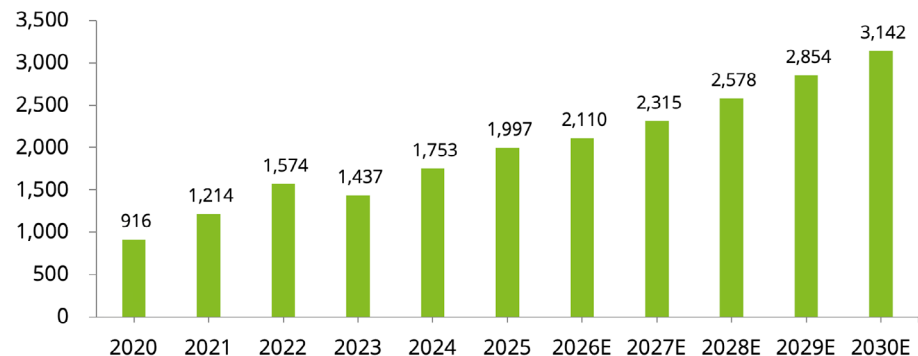
对于国内晶圆制造企业而言，这种多元化需求格局反而创造了更广阔的发展空间。依托本土化服务能力、较快的工艺导入响应和对下游客户需求的深度理解，国内厂商有机会在多个细分市场建立局部优势，并通过区域产业集群和上下游联动，形成更具韧性的产业生态。

（四）先进制程虽受限制，但头部企业正探索工艺迂回突破路径

在先进制程方面，受制于EUV光刻设备等关键条件限制，我国晶圆制造企业与国际领先水平仍存在明显差距。但值得关注的是，以中芯国际为代表的头部企业，正通过多重曝光、工艺整合优化及制程改良等方式，尝试提升7nm甚至5nm等级的工艺能力和实际产出水平，以满足部分国产高性能计算和AI芯片的制造需求。

这种路径虽然在成本、良率和产能效率方面仍面临不小挑战，但其意义在于：我国先进制造能力并未停滞，而是在约束条件下寻求“工程化突破”和“体系化迂回”。从产业战略角度看，先进制程的竞争不只是节点数字的竞争，更是工艺整合能力、设备适配能力、材料协同能力和客户定义能力的综合竞争。未来我国在先进制造领域的突破，可能并非简单沿袭国际龙头的单一路径，而是在受限环境中形成具有本土特点的差异化工艺演进路线。

图：中国晶圆代工行业市场规模（亿元）



数据来源：中商产业中国任命银行、中芯国际财报、头豹研究院

第二章 资本回归理性，半导体产业加速分化

随着IPO审核趋严、投资机构风险偏好回归理性，资本市场对半导体企业的支持方式正在从单纯融资扩张，转向质量筛选、资源重配和技术主线聚焦。这一变化将加速行业分化，具备高壁垒关键技术和现金流支撑能力的企业，将更容易获得资本和产业资源支持；商业化能力不足或技术壁垒不清晰的企业，则面临更强的生存压力。未来几年，中国半导体产业资本格局将由重数量转向重质量，由分散支持转向头部集中。

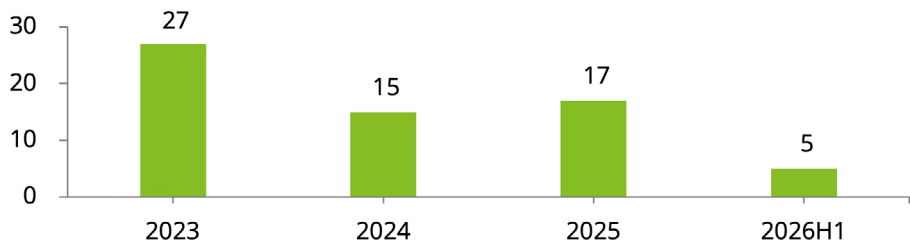
2.1. IPO：审核趋严推动上市资源向技术壁垒清晰的企业集中

当前，为落实“严把发行上市准入关”政策，IPO监管更加关注企业的硬科技属性、核心技术壁垒、关键环节突破能力、商业模式清晰度和持续盈利能力。因此，IPO资源正进一步向技术深度更强、产业价值更明确、经营基础更扎实的企业集中。

（一）A股资本转向优先支持更高质量的企业上市

国内半导体企业IPO数量已出现阶段性回落。表面上看，这是发行审核趋严和市场风险偏好下降的结果；从更深层看，则体现出资本市场从鼓励更多企业上市，转向优先支持更高质量企业上市。

图：国内半导体行业IPO数量



数据来源：Wind数据库

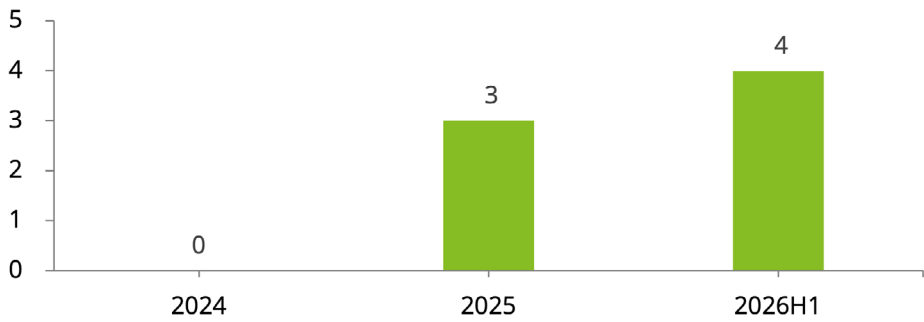
对行业而言，IPO节奏放缓具有双重影响。一方面，尚未形成稳定盈利能力、产品线不够清晰或技术护城河较弱的企业，融资难度和上市不确定性上升；另一方面，严格审核有助于提升上市公司整体质量，避免资本资源过度分散，推动优质企业通过上市进一步做大规模、强化研发和提升市场份额。长期来看，IPO数量收缩与质量提升并行，将有利于形成以头部企业为核心的产业竞争结构。

随着A股审核更加重视技术先进性、产业关键性和盈利可验证性，部分处于成长期的中小型半导体企业面临IPO周期拉长、审核不确定性提高和估值承压等问题。对这类企业而言，独立A股上市不再是唯一选择。部分企业通过并购进入头部企业体系，实现技术嫁接、客户协同；部分企业则转向港股市场，寻求更具弹性的融资窗口。

（二）“A+H上市”成为半导体企业拓宽融资渠道的重要选择

A+H上市热度持续提升，正成为中国半导体企业连接国际资本市场的重要方式。截至2026年5月底，年内宣布赴港上市的A股芯片公司达18家，覆盖半导体材料、存储、射频、模拟芯片和半导体设备等领域，显著高于往年同期水平。

图：半导体行业A+H上市企业数量（单位：家）



数据来源：烯牛数据

其中，澜起科技、兆易创新、豪威集团、国民技术等A股上市企业均已登陆港交所，合计募资近200亿港元。港股市场对半导体企业的吸引力主要是因为半导体企业研发投入高、资金需求大，赴港上市有助于拓宽融资渠道。且港交所在特专科技公司上市机制、市值门槛和审核流程方面持续优化，为尚处高研发投入阶段的企业提供了更灵活的资本路径。

（三）国内两大存储龙头上市提速，推动国产存储进入持续投入和体系化发展阶段

2026年，中国存储产业在资本市场取得重要进展。6月15日，证监会同意长鑫存储科创板IPO注册，公司拟募资295亿元，成为年内最大A股IPO；同期，长江存储于5月19日启动IPO辅导，上市进程迈出关键一步。两家企业分别聚焦DRAM和3D NAND闪存，是中国存储产业关键的龙头企业，更是国内存储芯片国产替代的重要支撑。

两大龙头上市的意义不只在拓宽融资渠道，更在于推动国产存储进入持续投入和体系化发展阶段。存储芯片技术迭代快、资本开支高、产能爬坡周期长，企业需要长期资金支持工艺升级、产品迭代和产能建设。长鑫和长江资本化提速，有助于增强国内在DRAM和NAND Flash两大关键存储品类上的持续投入能力，同时带动上游设备、材料、零部件和下游模组、服务器、消费电子、汽车电子等环节协同发展。这意味着国产存储领域正走向龙头带动的产业链体系化升级，也将进一步提升我国存储芯片的供应链韧性和全球竞争力。

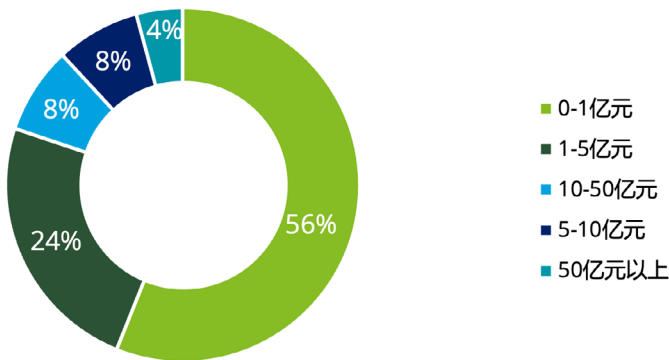
2.2. 横向并购提升市场集中度, 纵向整合增强产业链控制力

当前国内半导体并购仍处于以中小规模交易为主的阶段, 交易更多集中在细分环节内的能力补强和资源整合, 尚未形成大规模、跨领域的战略性整合。半导体行业并购涉及估值判断、技术承接、客户认证和供应链衔接等多重问题, 当前买方整体仍较为谨慎。随着企业估值逐步趋于合理、头部企业规模扩大以及产业链协同需求提升, 并购将成为推动行业出清、提升集中度和补齐技术短板的重要机制。

（一）当前并购仍以中小规模交易为主, 大型战略整合尚处起步阶段

近年来, 半导体行业并购数量有所上升, 但从交易规模看, 当前仍以中小型项目为主, 10亿元以上大型交易占比有限。这说明行业整合仍处于局部重组、技术补强和试探性协同阶段, 真正改变竞争格局的大型产业整合尚未全面展开。

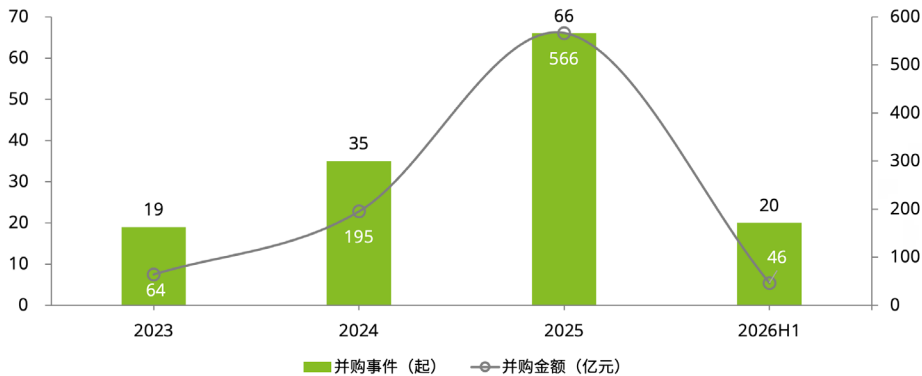
图：国内半导体行业并购事件金额分布



数据来源：烯牛数据

一方面, 半导体企业估值波动较大, 买卖双方对价格预期存在差异。另一方面, 半导体并购涉及核心技术、关键人才、客户体系和供应链资源, 整合复杂度较高, 对收购方的资本实力、管理能力和产业理解提出更高要求。随着行业估值逐步回归理性、政策工具持续完善、头部企业资本实力增强, 未来更大规模、更具战略意义的并购预计将逐步增加。届时, 并购将不仅是企业外延扩张手段, 也可能成为重塑中国半导体竞争格局的重要力量。

图：国内半导体行业并购事件数量（单位：起）



数据来源：烯牛数据

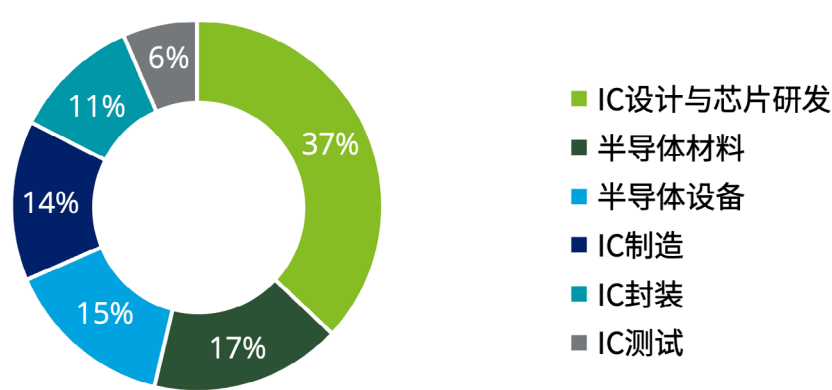
仅统计已完成的国内并购事件, 且并购方和标的方都属于半导体行业

（二）横向整合产品资源，纵向打通产业链环节

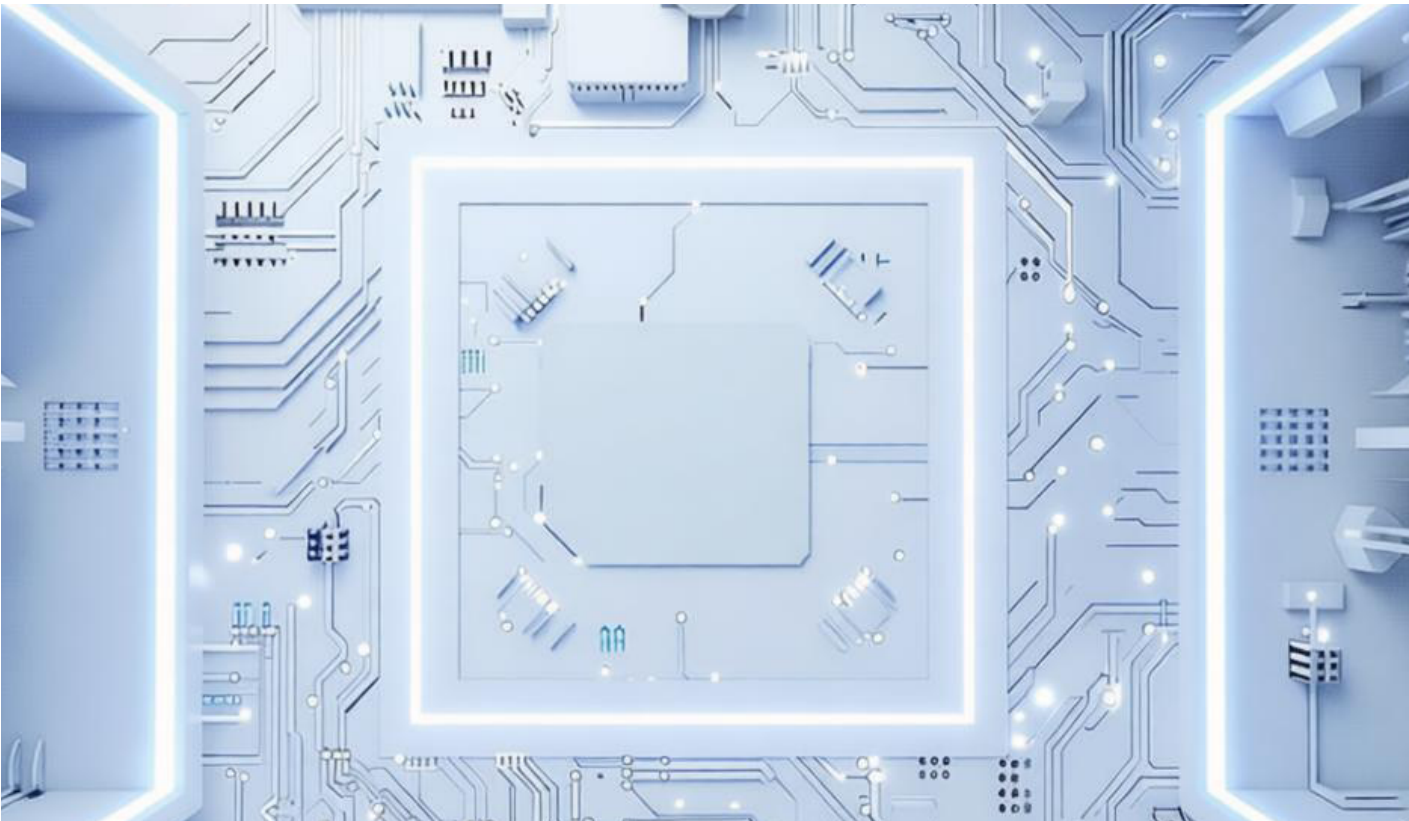
横向并购主要集中在模拟芯片、功率半导体等领域。这些赛道参与者众多，产品同质化程度较高，价格竞争压力较大。头部企业通过收购中小型设计公司，可以扩充产品矩阵、整合研发团队、提升客户覆盖能力，并增强渠道和议价能力。横向整合有助于减少重复建设，提升行业集中度，改善低水平竞争格局。

纵向整合则更多出现在制造、封测、材料和设备等环节。部分制造企业和封测龙头通过并购向上游材料设备或下游应用端延伸，以增强供应链协同和产业链控制力。该路径有助于打通研发、制造、封装、测试和市场导入环节，提升供需匹配效率，降低对单一外部供应商的依赖。在全球产业链波动加大、关键环节安全性要求提升的背景下，纵向整合的战略价值将进一步上升。

图：2025年至2026H1国内半导体行业并购事件分赛道占比



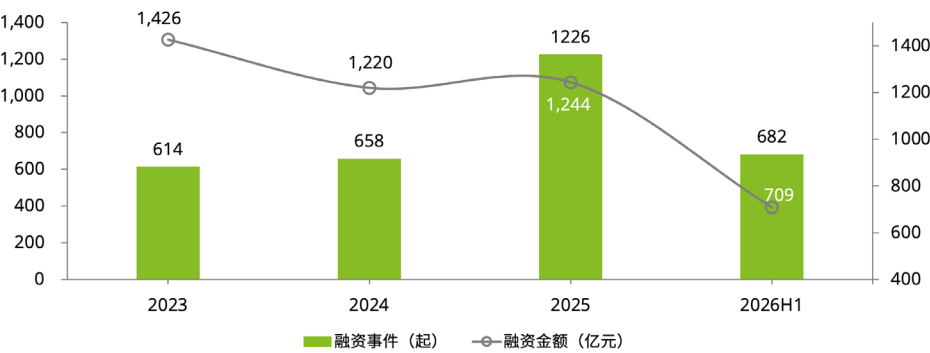
数据来源：烯牛数据



2.3. 投融资：交易活跃度维持高位，早中期项目仍具吸引力

融资事件数量持续增加。2023年，国内半导体公开股权融资共发生614起，融资总额为1426亿元；2024年融资事件小幅增至658起，同比增长7.17%；2025年，早期项目投资活跃度显著提升，全年融资事件达到1226起，融资总额为1244亿元。进入2026年上半年，行业融资热度延续高位，上半年累计完成融资682起，融资总规模达709亿元。

图：国内半导体行业融资事件数量及金额



数据来源：IT桔子、德勤研究

资本对早中期项目的关注仍然较高。2025年半导体投资中，A轮投资占比超过28%，B轮投资占比超过12%。从单笔融资规模看，5亿元以下项目占主导，其中1亿元以下占比81%，1至3亿元占比12%，3至5亿元占比2%。这一结构说明，投资机构正在通过投早、投小、投潜力来控制风险并布局未来关键赛道。早中期企业虽然规模较小、商业化不确定性较高，但往往在细分技术、工艺经验或特定应用场景中具备差异化优势。对于投资机构而言，在估值回归理性的阶段提前布局，有助于提升未来通过并购退出或成长为细分龙头的概率。

2.4. 新周期下存储产业投资逻辑升级

存储产业具有典型的资本密集、技术密集和强周期特征，存储企业盈利能力往往滞后于研发投入、制造能力建设以及市场拓展进程。特别是在产业发展初期或技术追赶阶段，亏损并不一定意味着企业竞争力不足，而更多反映了能力建设尚未完全兑现为经营成果。从行业发展规律来看，存储企业出现亏损，主要受到以下几个因素影响：

第一，产业周期波动导致价格下行，盈利能力容易受到短期影响。存储产品具有较强的标准化属性，市场价格主要由全球供需关系决定，DRAM、NAND Flash等产品价格普遍呈现明显周期波动。当手机、PC等消费电子需求恢复，终端出货回升带动渠道补货，价格随之修复，行业进入新一轮上行周期。

当行业进入供给过剩阶段，即使企业产品销量保持增长，也可能因价格下降而导致收入和利润承压。与此同时，存储制造具有典型的重资产特征，根据德勤研究，建一座晶圆厂通常从100亿美元起步，设备还要再加50亿美元。企业前期建设形成的大量固定资产折旧、设备维护以及运营成本难以随市场需求同步下降。行业景气下行阶段，产品价格下降与固定成本刚性叠加，使企业盈利能力往往先于经营能力恶化，也导致行业普遍出现阶段性亏损。

第二，技术追赶阶段投入前置，能力建设先于利润兑现。中国存储产业整体仍处于技术追赶和能力建设阶段。从产品研发、工艺验证、流片测试，到客户认证、规模量产和产品迭代，通常需要经历较长的发展周期。在这一过程中，企业需要持续投入研发、设备采购产线建设以及人才培养，而相关投入往往远早于收入和利润释放。此外，对于存储制造企业而言，产品良率持续提升是实现盈利的重要前提。在良率尚未稳定、制造成本仍处于下降阶段时，即使产品已经进入市场，也难以形成理想盈利水平。因此，技术投入、良率爬坡以及产品迭代能力的持续建设，是企业成长过程中不可避免的阶段性成本。

第三，国际竞争格局高度集中，新进入者盈利周期更长。全球存储市场长期由三星电子、SK海力士、美光科技等少数国际龙头企业主导，市场集中度较高。在行业景气下行阶段，领先企业凭借规模优势、成本优势及资金实力，往往具有更强的价格竞争能力，也能够通过调整资本开支和库存策略影响市场供需节奏。对于中国存储企业而言，在完成国产替代的同时，还需要面对全球领先企业的竞争压力。新进入者不仅需要持续完成客户认证、提升产品性能和扩大市场份额，还可能面临较长时间的价格竞争。因此，企业从实现产品量产到形成稳定盈利，通常需要经历比其他半导体赛道更长的培育周期。

第四，长期资本投入决定能力建设能否持续。存储产业从研发、流片、设备导入到规模量产，往往需要持续数年的资本投入。在形成稳定经营现金流之前，企业普遍依赖长期资本支持研发、产品升级及产能建设。若融资能力不足或资本投入中断，即使技术路线正确也可能因能力建设未完成而影响后续发展。可见，对于存储企业而言，融资能力不仅影响短期经营，更决定企业能否持续推进产品迭代、优化制造体系，并最终建立长期竞争优势。

因此，中国存储企业的发展关键正在从市场进入转向长期能力形成。回顾中国存储产业过去的发展历程，可以发现，那些最终实现突破的企业，通常都经历了较长时间的投入期在这一过程中，相比短期盈利，更值得关注的是企业是否持续释放出能力改善的信号。

基于上述逻辑，投资者可从五个维度升级中国存储企业的评估框架：

第一，持续改善产品良率。良率是判断企业技术爬坡和工程化能力的核心指标。良率提升意味着工艺稳定性增强、有效产出增加、单位成本下降，并有助于推动毛利率改善。投资者应关注企业良率是否持续提升，成本曲线是否下行，以及是否已从试产阶段进入稳定量产阶段。若企业在亏损阶段仍能持续改善良率，说明其盈利修复具备更强可验证性。

第二，缩小产品迭代与国际先进企业的差距。半导体竞争本质上是持续迭代能力的竞争。产品代际差异会直接影响性能、功耗、可靠性、客户认证和定价能力。投资者应关注企业产品路线图是否清晰，新产品推出节奏是否稳定，关键性能指标是否持续接近国际主流水平，以及产品方向是否匹配AI、汽车电子、工业控制、先进封装等高增长应用场景。

第三，亏损是否具备可修复性。亏损本身不是判断企业价值的终点，关键在于亏损原因是否可修复。若亏损来自周期底部、良率爬坡、产能利用率不足或研发投入前置，则随着需求修复、成本下降和客户导入，企业盈利能力有望改善。若亏损来自技术路线落后、产品同质化、客户结构单一或长期低价竞争，则可能反映企业竞争地位不足。

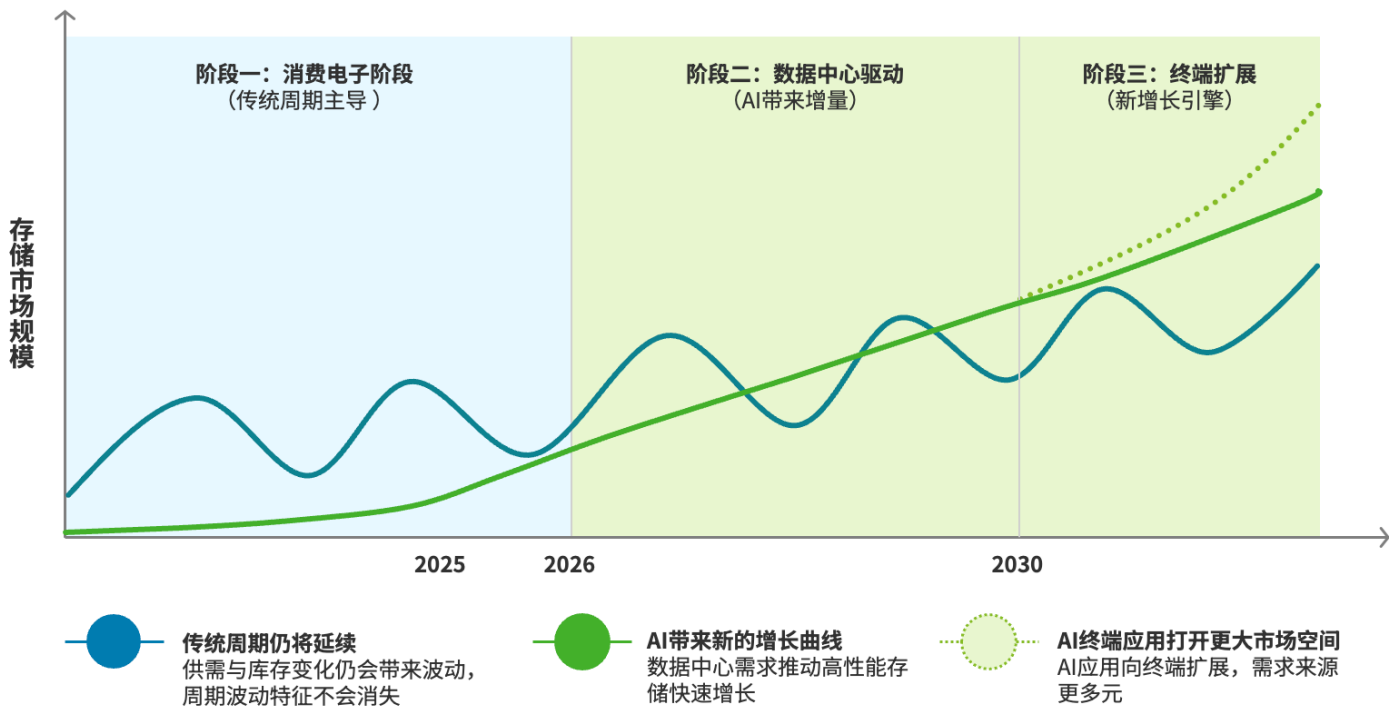
第四，现金流能够支撑至盈利拐点。半导体企业从研发验证到规模量产，再到稳定盈利，通常需要多年持续投入。即使技术方向正确，若资金无法支撑至商业化兑现，企业也可能面临经营风险。投

资者应关注企业现金储备、融资能力、资本开支节奏、客户回款情况以及是否具备国家级基金、地方国资或产业资本等长期资金支持。现金流支撑能力决定企业能否穿越技术爬坡期和行业周期波动。

第五，企业是否占据未来需求结构变化中的有利位置。AI带来的变化主要在于，产能正在被重新分配。越来越多新增投资开始流向HBM、DDA等高性能产品。2030年之后之关键变化可能来自AI推理能力向终端扩展。AI应用正在从云端向更多终端场景渗透，包括PC、手机、汽车、机器人以及工业与边缘设备。这

意味着未来的需求不再只来自少数大型公司，而是来自更多行业和更多设备。因此，未来增长并不取决于单一应用阶段是否结束，而在于AI应用是否完成从集中式基础设施向广泛终端场景的扩展。对于中国市场而言，这一趋势具有明显意义。中国既是全球主要存储消费市场，也是AI终端应用落地较快的市场之一。随着AIPC、新能源汽车与智能制造的持续发展，本土市场正在同时承接AI基础设施投资与国内终端应用扩展两条需求曲线。

图：存储行业周期性波动延续，AI驱动带来长期增长新曲线



第三章 供应链韧性：全链条受控演进，多节点分布式架构，实现系统性去风险与全球韧性

在全球科技竞争加剧、出口管制常态化以及地缘政治风险不断上升的背景下，半导体供应链安全已从企业运营问题上升为产业战略问题。对于中国半导体产业而言，过去“以效率为核心、以成本为导向、以全球化分工为基础”的供应链组织逻辑，正在加速转向“以安全为底线、以可控为目标、以韧性为支撑”的新模式。特别是在关键环节多次受到外部约束后，国内产业界对供应链风险的认识已从“单点替代”升级为“系统去风险”，对产业自主可控的理解也从局部国产化扩展到全链条可控、区域多节点布局 and 全球韧性构建。

这一变化意味着，中国半导体产业的供应链战略已不再只是简单推进某一设备、某一材料或某一芯片产品的国产替代，而是开始围绕“研发—设计—制造—封测—材料—设备—零部件—软件工具—国际交付”的完整链条进行系统重构。一方面，产业内部更加重视形成全链条受控能力，以降低关键单点失效对整体运行造成的冲击；另一方面，为兼顾国内安全与全球市场，中国企业也在探索多区域、多节点、分布式布局的新型供应链体系，以提高全球经营弹性和跨区域协同能力。总体来看，中国半导体供应链正从“局部修补”进入“体系重塑”阶段。

3.1 从单点国产化向全链条受控转型，形成全产业链受控，并推动全产业链技术升级

中国半导体供应链自主化进程正在经历显著升级。早期国产替代更多聚焦于少数受关注的核心环节，例如晶圆代工能力、关键芯片品类或个别设备类别，强调的是“在特定节点实现替代”。而当前供应链战略已明显转向全链条受控，即不仅要在某个关键环节实现国产化，更要确保上下游配套、工艺兼容、材料供给、设备维护和关键零部件来源等环节整体可控，从而实现真正意义上的系统去风险。

（一）国产化要求正从流片环节延伸至材料、设备核心部件等更深层链条

当前，企业对于供应链安全的要求已不再停留于“流片厂是否本土化”这一单一维度，而是不断向上游延伸至材料、设备及其核心部件领域。除了晶圆制造本身，企业越来越关注光刻胶、电子特气、硅晶圆、抛光材料、靶材以及大型设备子系统等关键投入要素的来源稳定性和可替代性。

这一趋势反映出产业界对供应链脆弱性的认识正在加深。因为在高度复杂的半导体制造体系中，任何一个看似配套性的环节失效，都可能导致整个产线停摆，甚至拖累研发和扩产节奏。比如，一条产线即便具备本土流片能力，若关键化学品、核心备件或设备维护依赖进口且无法稳定获得，仍然难以保证持续运行。因此，真正的供应链安全并不等于某个中心环节国产化，而在于各关键节点都具备可控替代、持续供给和快速切换能力。

（二）全产业链国产化与本土配套的核心意义在于系统性降低中断风险

推动全产业链国产化和本土化配套，其根本目的并不只是提高“国产占比”这一表面指标，而是通过增强每个关键环节的可控性，系统性降低供应链中断风险。对于半导体产业而言，风险往往并

非来自整体体系全面失效，而更多来自某一关键节点被“卡住”后引发的连锁反应。正因如此，供应链治理必须从“局部优化”转向“系统稳态”。

全链条受控的意义主要体现在三个层面。第一，能够增强企业产线连续运行能力，避免因单一材料、零部件或软件授权受限而导致整体生产中断；第二，能够提升企业对未来扩产和工艺升级的可预期性，减少外部不确定性对资本开支和客户交付的冲击；第三，能够倒逼本土产业链上下游协同升级，在真实应用场景中完成技术验证、产品迭代和能力积累，从而推动整个产业基础能力提升。

也就是说，全链条受控不仅是风险应对机制，更是产业升级机制。它促使国内企业从单点突破转向系统协同，从临时替代转向长期建设，最终形成更具韧性的本土生态。

（三）龙头企业正以系统协同方式推进供应链本土化，强化持续运营能力

近年来，国内龙头制造企业在遭遇外部限制后，已不再将战略重点单纯放在某一先进节点突破上，而是更加系统性地推进供应链本土化，目的在于提升整体产线持续运行能力和技术迭代稳定性。

例如，中芯国际在受限背景下，其发展思路已不仅仅是强调先进制程节点推

进，而是更加重视与国产设备、材料企业的深度协同。通过加强本土设备导入、提高关键材料国产替代比例、推动工艺适配联合开发等方式，其核心目标是确保产线在复杂外部环境下仍能保持稳定运营，并逐步建立更加独立的工艺生态。这种做法说明，制造企业的竞争重点正在从“单一节点追赶”转向“全供应体系可持续运行能力建设”。

再如，长江存储在出口管制背景下，也在持续加强与国内刻蚀设备、薄膜设备厂商的协同合作，同时提升材料国产替代比例，以保障扩产节奏和技术迭代能力不受单点限制影响。对于存储这样资本密集、节奏敏感的行业而言，供应链某一环节失效就可能对成本结构、良率爬坡和市场节奏造成放大冲击。因此，长江存储推动本土协同并非被动应对，而是在建立长期可持续的制造能力基础。

从这些案例可以看出，中国半导体供应链自主化已进入“龙头牵引、链条协同、体系构建”的阶段。未来，谁能率先形成稳定、完整、可持续迭代的本土供应体系，谁就更有可能在复杂外部环境中保持战略主动。

3.2 供应链构建正向多节点分布式布局演进

如果说全链条受控强调的是“内部可控”，那么多节点分布式布局强调的则是“外部韧性”。在全球供应链重构趋势下，越来越多半导体企业意识到，单一国家、单一区域或单一运营中心的高度集中布局，虽然在和平时具有成本和效率优势，但在地缘政治、贸易限制和市场割裂加剧的环境中，集中化结构也意味着更高的系统脆弱性。因此，供应链架构正在从中心化模式转向多区域、多节点、分布式网络，以实现风险分散、能力冗余和全球交付弹性。

（一）全球半导体供应链正由中心化走向多区域多节点网络化布局

近年来，全球半导体供应链呈现出明显的“去单中心化”趋势。企业不再将研发、制造、采购和市场交付过度集中在单一地点，而是通过在不同地理区域设立研发中心、运营总部、制造基地和后端服务节点，构建具备更强恢复能力的分布式网络。

这一趋势背后的驱动力主要包括：地缘政治不确定性上升、出口管制规则变化频繁、跨境物流与贸易成本波动加大，以及客户对本地化交付和合规经营的要求提高。对于半导体企业而言，多节点布局虽然会提高组织复杂度和运营成本，但其带来的风险对冲价值正在显著上升。特别是在高端芯片、先进制造和国际市场交付高度敏感的情况下，构建跨区域弹性网络已成为企业全球化运营的必要选择。

对于中国企业而言，分布式布局不仅是出海策略的一部分，更是平衡“本土安全”与“全球经营”的现实路径。

（二）“双总部架构”成为平衡国内安全与国际经营的重要探索

为了同时满足国内自主攻坚和国际市场开拓的双重需求，部分中国半导体企业正尝试推行“双总部架构”。这种模式的本质，是通过将不同职能在地理上进行有意识分工，在保持核心技术和战略控制权留在国内的同时，增强海外业务的合规性和运营灵活性。

此外，中国总部通常承担核心技术研发、自主创新攻关、国家项目承接以及国内市场深耕等职能，是企业技术主权和战略资源的核心载体；而海外或国际总部则主要负责海外客户服务、全球供应链采购、国际商务拓展、境外资本运作及合规风险管理，是企业连接全球市场和外部资源的重要接口。

这一架构反映出中国半导体企业全球化逻辑的升级：出海不再只是简单销售产品，而是围绕合规、资本、人才、供应链和客户关系进行系统布局。通过“双总部”模式，企业能够在一定程度上降低单一主体面临的管制风险，增强对国际规则环境的适应能力，同时保持国内研发体系和产业根基的稳定性。未来，这种模式有望在更多具备国际拓展需求的芯片设计、设备、材料及封测企业中得到复制。

（三）新加坡正在成为中国半导体企业出海与全球合规的重要枢纽

在中国半导体企业的海外布局中，新加坡的重要性正快速上升。其角色已不再只是传统意义上的贸易中转港，而逐渐演变为中国半导体企业开展国际业务、进行全球资源配置和实现合规运营的关键枢纽。从区位、制度、金融、人才和国际连接能力来看，新加坡正在成为中国企业构建海外节点网络的优选目的地之一。

首先，新加坡具备较强的国际金融和专业服务能力，能够为半导体企业提供资本运作、财税安排、知识产权管理和跨

境交易支持。随着香港18C章与新加坡经济发展局（EDB）等政策体系形成一定联动，不少中国芯片企业开始将新加坡作为财务中转站和国际人才引入中心，以提升资本国际化运作能力和全球组织配置能力。

其次，新加坡与马来西亚之间正在形成具有吸引力的跨境半导体生态，尤其是“新加坡设计/总部 + 马来西亚（新山/槟城）后端封测”的模式，正为中国企业进入“非中非美”供应链体系提供现实路径。通过这种布局，企业可以在保留亚洲运营优势的同时，增强对北美和欧洲市场的产品交付能力和供应链合规性，从而更好地适应全球客户多元化采购要求。

再次，在地缘政治不确定性加大的背景下，新加坡也被不少企业视为相对稳定的“地缘避风港”。部分国产GPU企业和先进制程相关企业通过在新加坡设立实体，以争取更灵活的国际业务安排，包括获取特定制程资源、软件授权或与国际客户开展更顺畅的合作。这并不意味着企业核心能力外移，而是说明其正通过多节点布局为全球经营建立更具缓冲性的外围支撑体系。

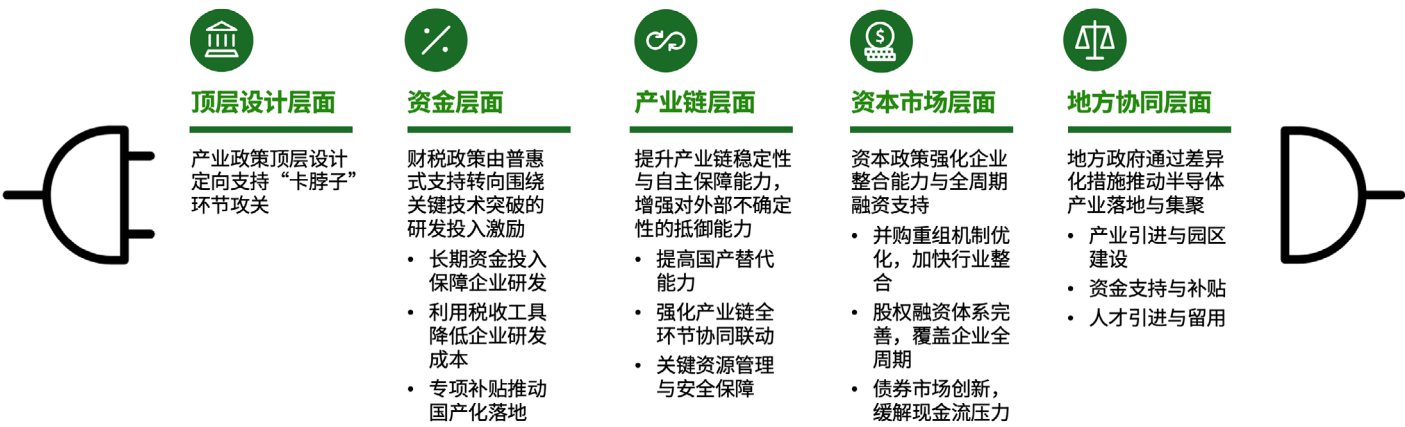
总体看，新加坡在中国半导体企业全球布局中的角色，正在从“贸易节点”升级为“合规节点、资本节点、人才节点和生态节点”。这一变化将对未来中国半导体产业的国际化路径产生持续影响。

第四章 政策引领：国内政策体系聚焦自主可控、高端突破与全链协同，推动半导体产业向系统性能力建设转型

半导体产业具有技术门槛高、投资周期长、外部性强和战略属性突出的典型特征，决定了其发展不仅依赖市场机制，更高度依赖国家层面的战略引导与政策体系支持。近年来，面对全球科技博弈加剧、关键环节外部约束持续强化以及国内产业升级需求快速提升的复杂环境，我国半导体政策体系正在加速从早期的“鼓励发展、扩大规模”转向当前的“自主可控、高端突破、全链协同、系统建设”新阶段。

这一轮政策演进的显著特征在于：一方面，顶层设计更加聚焦“卡脖子”环节和底层能力建设，政策目标由数量扩张转向关键能力突破；另一方面，财税、资金、资本市场、产业链协同和地方支持政策不断形成组合拳，政策工具箱更加丰富，支持方式更加精准。总体看，国内半导体政策体系正从“点状扶持”向“体系赋能”演化，其目标不只是帮助企业扩大生产和融资规模，更在于推动产业形成贯穿研发、制造、配套、资本和人才的系统性能力，从而增强在全球不确定环境中的战略韧性和可持续竞争力。

图：半导体产业主要政策发展方向



4.1 顶层设计层面：国家半导体产业政策顶层设计定向支持“卡脖子”环节攻关

顶层设计是半导体产业政策体系的方向盘。近年来，国家层面围绕集成电路和相关关键技术领域持续加强中长期战略规划，政策导向日益明确，即将有限资源更加集中地投向关键核心技术和底层基础能力，推动产业由“面上铺开”转向“重点攻坚”。

（一）纲领性文件持续出台，重点支持方向更加清晰

通过《集成电路产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》等纲领性文件，国家层面进一步明确了未来一个时期我国半导体产业发展的主攻方向、重点任务和保障机制。这类文件的核心作用，不仅在于提出目标，更在于为中央部门、地方政府、产业基金和市场主体提供统一的政策预期和行动框架。

从政策逻辑看，新一轮顶层设计更加突出“高质量发展”导向，不再单纯强调产值规模和投资扩张，而是强调创新能力、关键技术突破、供应链韧性和生态体系建设。这说明我国半导体政策思路已经由过去偏重“做大产业”，转向更加重视“做强能力”和“做稳体系”。对于企业而言，政策方向的清晰化有助于提高资源配置效率，减少盲目扩张和重复建设，引导更多资本、人才和技术力量向真正关键的方向聚集。

（二）政策资源向底层基础环节集中，聚焦“卡脖子”领域突破

在具体支持重点上，国家政策资源正更加明确地向产业链底层基础环节集中，定向支持高端芯片、光刻机、EDA工具、大硅片等“卡脖子”领域攻关。这

一变化具有鲜明的战略取向，即优先补足最易受制于人的薄弱环节，提升产业底座安全性和自主创新能力。

与产业链中部分已具备一定市场竞争基础的环节相比，底层基础环节往往具有投入大、回报周期长、验证难度高和市场壁垒强等特点，仅靠市场自发力量较难在短期内形成突破。因此，国家层面的定向支持对这些领域尤为关键。从更深层次看，政策聚焦底层基础环节，并非只是为了突破若干单项技术，更是为了夯实整个产业链的“根技术”和“根能力”。只有在EDA、装备、材料、核心器件等底层能力上取得持续进展，半导体产业才能真正摆脱对外部关键资源的高度依赖。

4.2 资金层面：国家财税政策由普惠式支持转向围绕关键技术突破的研发投入激励

资金与财税政策是半导体产业支持体系中最直接、最具操作性的抓手。当前我国半导体财税政策的一个显著特征，是由过去相对普惠、偏重覆盖面的支持方式，逐步转向围绕关键技术突破和研发持续投入的精准激励模式。政策不再只是帮助企业降低一般经营成本，而更强调通过长期资本供给和研发导向激励，支持企业投入高投入、高风险、长周期的关键技术领域形成持续攻关能力。

（一）长期资金投入持续加码，为企业研发和扩产提供稳定支撑

半导体产业的核心竞争力来自长期研发积累和工程化能力沉淀，因此稳定、耐心、可持续的长期资本至关重要。近年来，国家集成电路产业投资基金三期、人工智能产业投资基金等国家级资金平台持续设立和推进，为产业发展提供了重要资本支持。这类基金具有较强的战略导向性，能够在商业资本相对谨慎或短期收益不明确的领域发挥引导作用。

相较于一般市场化资金，国家级产业基金更强调中长期布局和关键环节突破，既可支持装备、材料、EDA等前期回报较慢但战略价值突出的领域，也可促进

产业链上下游协同投资，形成更强的资源整合效应。其意义不仅在于向企业注入资金，更在于释放明确的政策信号，带动地方资本、社会资本和产业资本共同参与关键技术布局，增强产业整体投入强度。

（二）税收工具持续优化，系统性降低企业研发与生产成本

在税收政策方面，国家正通过一系列工具降低半导体企业研发和生产负担，包括研发费用加计扣除比例提升、阶梯式企业所得税减免、增值税加计抵减等多项财税优惠政策。对于研发密集型半导体企业而言，这类政策的直接作用在于改善企业现金流状况，降低高强度研发投入对短期盈利能力的挤压。

更重要的是，税收激励能够提高企业持续研发的意愿和能力。半导体企业尤其是处于关键技术攻关阶段的企业，往往需要在较长时间内保持高研发投入，而短期内难以充分释放收入和利润。税收优惠在一定程度上弥补了这一结构性矛盾，有助于企业坚持长期主义，避免因短期成本压力削弱研发节奏。从产业政策逻辑看，这体现出国家支持方式正在

由“事后补贴”更多转向“事前减负”和“过程激励”，从而更好适应技术攻关的长期性特征。

（三）专项补贴与应用支持并行，加快国产化落地和工程化验证

除基金和税收支持外，围绕半导体设备、材料和产业链协同的专项补贴政策也在持续完善。例如，围绕半导体设备国产化推进方案、产业链供应链协同发展行动计划、计量支撑产业新质生产力发展行动方案等专项政策，政府正通过应用补贴、首台套支持、验证支持和示范推广等方式推动国产产品更快进入实际场景。

对于半导体产业而言，很多国产设备和材料的难点不只是研发出来，而在于能否跨越客户导入门槛并完成工程化验证。专项补贴的作用，正是降低企业和客户在导入初期的试错成本，提升下游客户使用国产方案的意愿，帮助本土供应商更快完成产品迭代和良率爬坡。可以说，这类政策连接了“实验室突破”和“产业化应用”之间的关键一环，对加速国产替代由技术层面走向商业层面具有现实意义。

4.3 产业链层面: 提升产业链稳定性与自主保障能力, 增强对外部不确定性的抵御能力

在当前国际环境下, 单个企业的技术突破已不足以完全应对外部冲击, 半导体产业政策越来越强调产业链整体稳定性、自主保障能力和风险应对能力。由此, 政策重点从支持个体企业发展, 进一步扩展到支持产业链协同联动、质量管理体系建设和关键资源安全管理, 推动形成更有韧性的产业组织结构。

(一) 完善质量认证体系, 提高国产替代的可信度和可用性

提高国产替代能力, 不能仅依赖供给端产品数量增长, 更需要建立完善的质量认证体系和产业标准体系。当前, 国家和行业层面正持续完善半导体材料与设备的质量认证机制, 以提升国产产品的一致性、可靠性和客户信任度。

这是国产替代由“试用阶段”走向“批量导入阶段”的关键基础。对于晶圆制造、封装测试和高端设计客户而言, 产品能否被采用, 不仅取决于性能参数是否达标, 更取决于其在稳定性、重复性、可追溯性和长期供货能力上的综合

表现。因此, 完善认证体系的意义, 在于让国产材料和设备从“可选项”真正变为“可用项”“可信项”, 从制度层面降低下游客户导入风险, 提升产业链内循环效率。

(二) 强化全环节协同联动, 提升对外部冲击的整体应对能力

半导体产业链条长、环节多、耦合度高, 任何单一环节的波动都可能向上下游传导。因此, 政策层面正更加重视芯片设计、制造、封测、设备、材料和应用端之间的全环节协同联动, 通过协同研发、联合验证、信息共享和供需对接等方式, 提高产业链面对外部冲击时的整体稳定性。

这种协同思路的核心, 在于把供应链安全从个体企业问题提升为系统工程。例如, 当海外供应链出现波动时, 若设计企业、晶圆厂、封测厂和本土材料设备企业能够更快实现联动调整、工艺切换和替代验证, 就能大幅降低风险外溢效应。未来, 产业链政策的重点之一将是

推动形成更高效的协同响应机制, 使我国半导体产业在不确定环境下具备更强的“自我修复”能力和快速调整能力。

(三) 加强关键资源管理与安全保障, 提升产业安全主动性

在产业安全维度, 关键资源管理正成为政策体系的重要组成部分。包括稀土相关物项出口管制在内的一系列资源管理措施, 体现出我国在关键战略资源管理上正更加主动, 也更重视通过资源安全来提升产业安全的主动权与防御能力。

其政策逻辑在于, 半导体竞争不只是设备、工艺和芯片层面的竞争, 也涉及关键原材料、特殊金属和战略资源保障能力。通过加强关键资源管理, 我国不仅能够更好维护本国产业链安全, 也在全球科技产业博弈中提升了制度性筹码。对国内半导体产业而言, 这类政策能够增强对关键资源供给的可预期性, 并推动企业更加重视资源替代、循环利用和供应链前瞻布局。

4.4 资本市场层面：资本政策强化企业整合能力与全周期融资支持

资本市场是半导体产业实现资源优化配置、支持科技创新和推动企业做大做强的重要制度平台。当前，围绕“硬科技”导向，资本市场政策正更加重视半导体企业不同发展阶段的融资需求与整合需求，通过并购重组、股权融资和债券融资等多元工具，构建覆盖企业全生命周期的资本支持体系。

（一）并购重组机制持续优化，加快行业整合和优质资产集聚

近年来，证监会围绕并购重组机制改革不断出台政策，“并购六条”及相关配套措施明确支持“硬科技”领域通过并购重组实现做大做强。通过设立快速并购通道、加快审核节奏、提高制度便利性，监管部门正在为半导体企业收购创新资产、整合关键技术团队和补足产业链短板提供更友好的政策环境。

对半导体行业而言，这一政策导向意义重大。由于行业技术迭代快、细分赛道多、研发资源分散，单靠企业内部逐项突破的效率往往有限。并购重组可以帮助头部企业更快获得技术、团队和客户资源，也有助于中小企业在IPO难度上

升背景下通过被整合实现价值转化。资本政策对并购的支持，实质上是在推动行业集中度提升和资源向优质主体汇聚，从而提升整个产业的竞争效率。

（二）股权融资体系持续完善，逐步覆盖科技企业全周期发展需求

在股权融资层面，监管体系正通过完善科技企业上市、再融资、并购、产业基金等多元渠道，为半导体企业提供覆盖全生命周期的资本支持。对于处于不同阶段的企业而言，政策导向并不再局限于“是否能够上市”，而是更加注重建立多层次、可衔接的融资体系。

这一体系的价值在于：初创期企业可通过政府引导基金、产业基金和创业投资获得早期资本；成长期企业可通过私募融资、并购整合和区域性资本市场完成能力积累；成熟期企业则可借助A股、港股以及再融资工具扩大规模、推进并购和国际化布局。对于半导体这样一个从技术研发到产业化往往需要跨越多年周期的行业而言，形成全周期融资支持体系，有助于减少企业在关键成长节点上的资本断层风险。

（三）债券市场创新加快，缓解硬科技企业现金流压力

除股权融资外，债券市场也开始在支持科技创新企业方面发挥更重要作用。近年来，监管部门发布了《关于推出科技创新债券构建债市“科技板”的通知》等系列文件，旨在通过债券工具创新更好服务硬科技企业融资需求，尤其是缓解中小规模科技企业现金流紧张、融资渠道单一的问题。

对半导体企业而言，债券融资的引入有助于优化融资结构，降低对单一股权融资的依赖，特别是在设备投入、产线建设和阶段性营运资金安排方面可发挥重要补充作用。虽然相比成熟行业，半导体企业债券融资的适用范围仍相对有限，但随着政策制度不断完善，债券市场有望成为硬科技企业融资工具箱中的重要组成部分，进一步提升产业资本供给的多样性和稳定性。

4.5 地方协同层面: 地方政府通过差异化措施推动半导体产业落地与集聚

半导体产业发展既依赖国家层面的战略引导,也离不开地方政府在空间承载、资源配套和产业服务方面的具体落实。近年来,地方政府在国家政策框架下,结合自身产业基础、区域定位和资源禀赋,采取差异化措施推动半导体产业落地、集聚和升级,逐步形成了多层次、多区域协同发展的格局。

(一) 依托本地基础推进产业引进与园区建设

各地普遍将半导体作为战略性新兴产业重点布局方向,依托当地已有的电子信息产业基础、高校科研资源和制造配套能力,引进芯片设计、制造、封测、设备和材料企业,建设专业产业园区和区域性产业集群。园区化和集群化布局有助于降低企业间协作成本,提高要素配置效率,并形成上下游协同发展的局部生态。

不同地区在布局重点上也体现出明显差异。例如,有的地区更适合发展设计与软件生态,有的地区更适合承接制造和封测项目,有的则聚焦设备材料或第三代半导体等细分赛道。这种差异化发展,有助于避免全国范围内简单重复建设,提高区域产业布局的整体效率。

(二) 通过专项资金和补贴增强项目落地吸引力

在资金支持方面,地方政府通常通过专项财政资金、研发补助、流片补贴、设备购置补贴、租金减免和产业基金配套等方式,降低企业项目落地和初期运营成本。对于半导体企业而言,早期资本开支高、回报周期长是普遍痛点,地方层面的财政工具可以在关键阶段发挥明显杠杆作用。

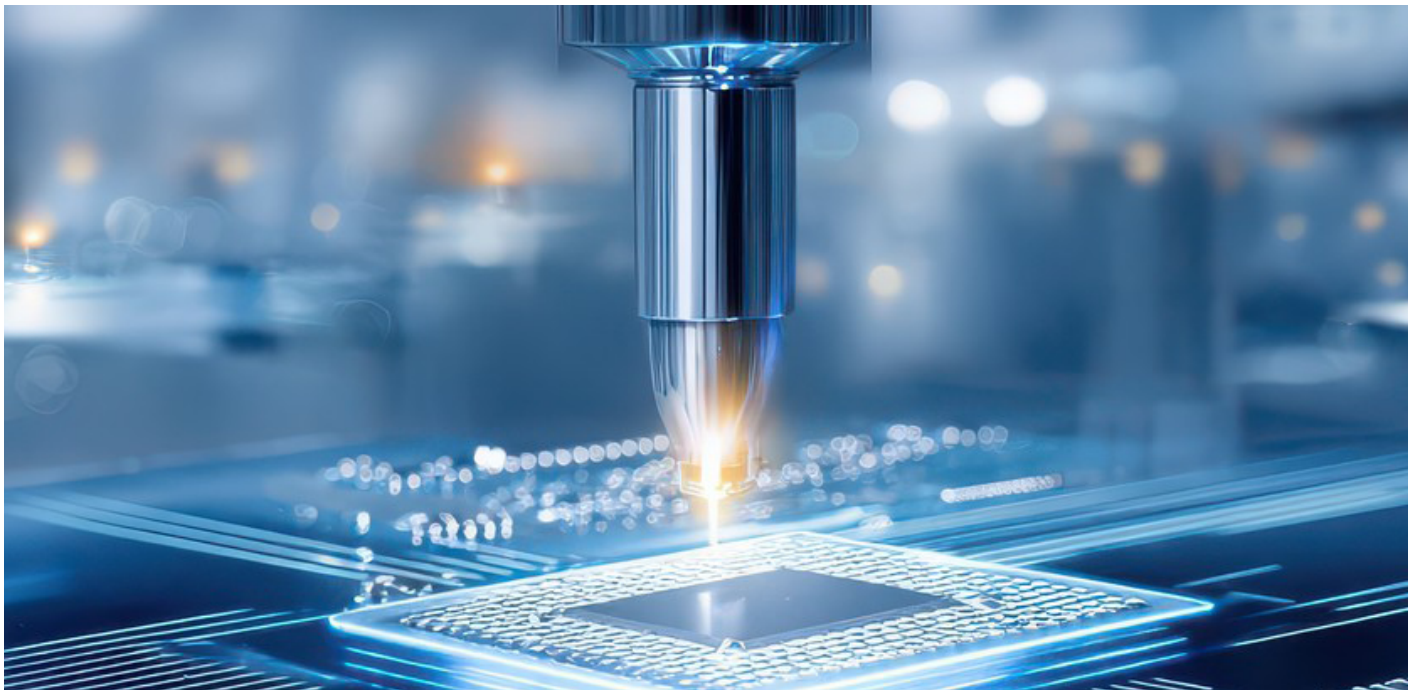
这类支持不仅有助于吸引企业投资落地,也能够增强地方在争取优质项目和龙头企业布局中的竞争力。尤其对于制造、封测和设备材料类项目,地方资金支持往往直接影响项目选址和建设进度。未来,地方政策的竞争重点将不只是补贴力度,更在于能否提供更高质量的产业服务、协同资源和长期发展环境。

(三) 以人才政策强化产业长期发展支撑

半导体产业归根到底是人才密集型产业。地方政府在推动产业发展的过程中,正越来越重视通过个税优惠、住房补贴、子女教育、科研支持和创业服务等综合政策,吸引和留住高端研发人才、工程人才和管理人才。

从现实情况看,人才供给已成为制约半导体产业持续发展的关键变量之一。无论是高端工艺工程师、EDA研发人员、设备调试专家,还是具备国际视野的产业管理人才,都具有较高稀缺性。地方政府若能在人才引进与留用机制上形成系统优势,往往能够显著提升本地产业集聚质量和可持续发展能力。因此,人才政策已不仅是配套性政策,而正在成为地方半导体竞争力的重要组成部分。

未来展望：我国半导体产业将进入以体系韧性、规则适应与战略主动为核心的新阶段



展望未来，我国半导体产业将进入一个由高速扩张转向深度重构、由局部突破转向体系竞争、由要素驱动转向能力驱动的新阶段。产业发展的决定性因素，将不再主要是单一技术节点、单个市场机会或阶段性资本热度，而是能否在全球产业格局持续重塑的背景下，建立兼具战略韧性、资源整合效率、制度适应能力与持续创新能力的产业体系。换言之，未来半导体竞争的核心，将不只是“能否做出来”，而是能否长期稳定地做下去、持续迭代下去、并在复杂环境中保持发展主动权。

从全球视角看，半导体产业已经从一个

典型的全球化分工产业，演变为兼具经济竞争、科技博弈与战略安全属性的关键基础产业。其运行逻辑正在发生深刻变化：效率仍然重要，但不再是唯一目标；开放仍然必要，但不再意味着对单一路径的依赖；增长仍将持续，但增长本身已不再是产业发展的最高目标。未来行业更看重的是，在高不确定性环境下是否具备稳定运营能力、关键资源调动能力、跨周期投入能力以及对外部规则变化的适应能力。这意味着，半导体产业的竞争边界正在从企业层面上移到产业体系层面，从产品竞争延伸到生态竞争，从市场份额竞争升级为综合国力和产业组织能力竞争。

对于我国而言，未来半导体产业的战略命题，也将从“追赶先进”逐步转向“塑造能力”。这一变化尤为关键。过去很长一段时间，产业发展的焦点主要在于缩小差距、补足短板、扩大规模；而未来，更重要的是在已有基础上形成稳定的能力结构、清晰的战略层次和持续演进的内生机制。真正决定产业高度的，不再只是某一环节能否突破，而是整个产业是否能够形成从技术研发、工程实现、资本供给、政策支持到市场应用之间的高效联动，是否能够把短期投入转化为长期能力，把局部成果转化为体系优势，把外部压力转化为内部重构的动力。

可以预见，未来我国半导体产业将越来越呈现出集中、体系化、韧性发展的特征。产业内部的分化将进一步加深，资源将更快向具备平台能力、组织能力和长期主义导向的主体集中。行业竞争也将更加体现为综合能力竞争：不仅要有研发能力，还要有产业协同能力；不仅要有市场能力，还要有规则应对能力；不仅要有扩张能力，还要有穿越周期和抵御波动的能力。未来真正具备引领作用的，不一定是某个单点最强的企业，而更可能是那些能够连接多类资源、承接多重任务、统筹多地布局、并形成稳定生态影响力的平台型主体。

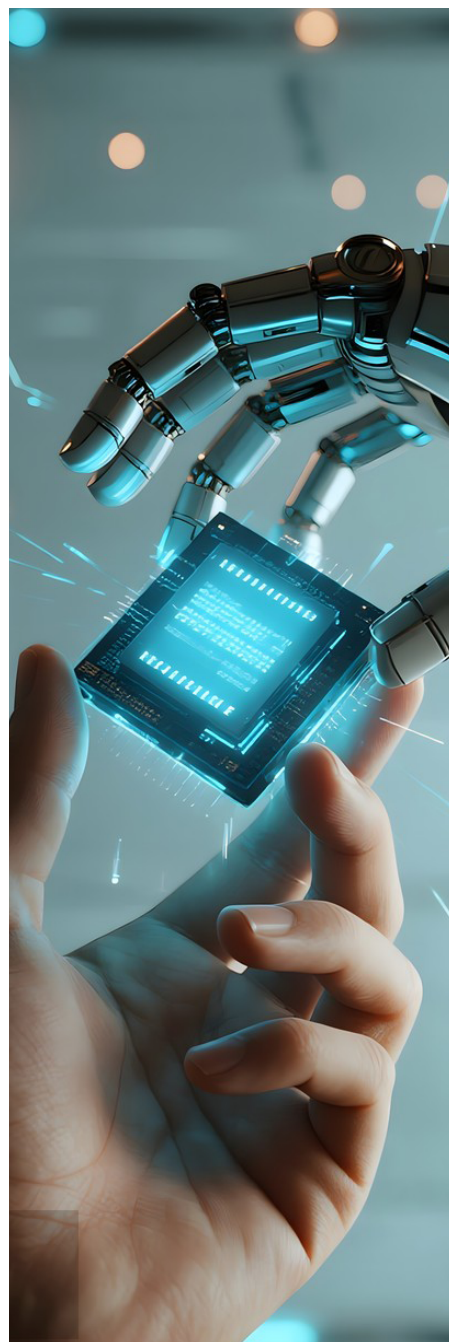
与此同时，全球化不会终结，但其形态将发生根本变化。未来的全球参与，不会再简单遵循过去以成本效率和规模扩张为核心的传统路径，而将更多建立在规则适应、合规治理、区域协同和风险分散基础之上。对于中国半导体产业来说，未来的发展不是在“内循环”与“外循环”之间做单选题，而是在保障自身战略安全的前提下，探索更加稳健、更具弹性、更能适应多元规则环境的全球参与方式。谁能够在本土根基与国际布局之间建立更高水平的平衡，谁就更有可能在未来复杂多变的产业格局中获得持续空间。

从更深层次看，未来我国半导体产业的成败，将越来越取决于能否完成从“产业建设”到“产业治理”的升级。所谓产业建设，重点在于投项目、扩规模、

补链条；而产业治理，则更强调资源配置效率、区域布局优化、制度协同、风险管理和长期激励机制。未来，简单依赖投资冲动、局部补贴或短期市场红利的发展模式将难以为继，取而代之的将是更加注重战略定力、结构优化和长期回报的治理逻辑。谁能够率先建立起更成熟的产业治理框架，谁就更能避免低水平重复、提升体系效率，并把有限资源集中到最具战略价值的方向上。

总体而言，我国半导体产业未来的发展，不太可能是一条线性上升、全面同步突破的路径，而更可能是一个在约束中重构、在波动中优化、在竞争中走向成熟的过程。在这一过程中，产业的真正进步，不仅体现为规模是否更大、技术是否更先进，也体现为体系是否更稳、结构是否更优、主体是否更强、生态是否更有组织力。可以说，未来半导体产业的关键，不只是继续增长，而是实现从“增长型产业”向“战略型产业”、从“项目驱动型发展”向“能力驱动型发展”、从“局部竞争优势”向“整体体系优势”的跃迁。

从这个意义上看，未来我国半导体产业最值得期待的，并非某一个单点突破本身，而是经过持续积累之后，逐步形成一种更具韧性、更具自主性、更具全球适应力的产业新形态。一旦这种形态得以建立，中国半导体产业在全球格局中的角色，也将由重要参与者逐步走向关键塑造者。



德勤中国联系人

金凌云

德勤中国首席业务增长官

电邮: lawrjin@deloittecn.com.cn

陈颂

德勤中国半导体行业主管合伙人

电邮: leoschen@deloittecn.com.cn

廉勋晓

德勤中国科技行业主管合伙人

电邮: mlian@deloittecn.com.cn

钟昀泰

德勤中国科技、传媒和电信行业研究总监

电邮: rochung@deloittecn.com.cn

办事处地址

北京

北京市朝阳区针织路23号楼
国寿金融中心12层
邮政编码：100026
电话：+86 10 8520 7788
传真：+86 10 6508 8781

长沙

长沙市开福区芙蓉中路一段109号
华创国际广场2号栋1317单元
邮政编码：410008
电话：+86 731 8522 8790
传真：+86 731 8522 8230

成都

成都市高新区交子大道365号
中海国际中心F座17层
邮政编码：610041
电话：+86 28 6789 8188
传真：+86 28 6317 3500

重庆

重庆市渝中区瑞天路10号
企业天地8号德勤大楼30层
邮政编码：400043
电话：+86 23 8823 1888
传真：+86 23 8857 0978

大连

大连市中山路147号
申贸大厦15楼
邮政编码：116011
电话：+86 411 8371 2888
传真：+86 411 8360 3297

广州

广州市珠江东路28号
越秀金融大厦26楼
邮政编码：510623
电话：+86 20 3888 0120
传真：+86 20 3888 0115

海口

海南省海口市美兰区国兴大道3号
互联网金融大厦B栋1202单元
邮政编码：570100
电话：+86 898 6866 6982

杭州

杭州市上城区飞云江路9号
赞成中心东楼1206-1210室
邮政编码：310008
电话：+86 21 3313 8000
传真：+86 571 8779 7916

哈尔滨

黑龙江省哈尔滨市南岗区
中山路193号中实大厦703室
邮政编码：150001
电话：+86 451 8586 0060

合肥

安徽省合肥市蜀山区潜山路111号
华润大厦A座1506单元
邮政编码：230031
电话：+86 551 6585 5927
传真：+86 551 6585 5687

香港

香港金钟道88号
太古广场一座35楼
电话：+852 2852 1600
传真：+852 2541 1911

济南

济南市市中区二环南路6636号
中海广场28层2802、2803、2804单元
邮政编码：250000
电话：+86 531 7668 2398
传真：+86 531 7668 2389

澳门

澳门殷皇子大马路43-53A号
澳门广场19楼H-N座
电话：+853 2871 2998
传真：+853 2871 3033

南昌

南昌市红谷滩区绿茵路129号
联发广场写字楼41层08-09室
邮政编码：330038
电话：+86 791 8387 1177

南京

南京市建邺区江东中路347号
国金中心办公楼一期40层
邮政编码：210019
电话：+86 21 2312 7003
传真：+86 25 8691 8776

宁波

宁波市海曙区和义路168号
万豪中心1702室
邮政编码：315000
电话：+86 574 8768 3928
传真：+86 574 8707 4131

青岛

山东省青岛市崂山区香港东路195号
上实中心9号楼1006-1008室
邮政编码：266061
电话：+86 532 8896 1938

上海

上海市延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码：200002
电话：+86 21 6141 8888
传真：+86 21 6335 0003

沈阳

辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号
沈阳市府恒隆广场办公楼1座
3605-3606单元
邮政编码：110063
电话：+86 24 6785 4068
传真：+86 24 6785 4067

深圳

深圳市深南东路5001号
华润大厦9楼
邮政编码：518010
电话：+86 755 8246 3222
传真：+86 755 8246 3186

苏州

苏州市工业园区苏绣路58号
苏州中心广场58幢A座24层
邮政编码：215021
电话：+86 21 3313 8888

天津

天津市和平区南京路183号
世纪都会商厦办公室45层
邮政编码：300051
电话：+86 22 8312 6199
传真：+86 22 8312 6099

武汉

武汉市江汉区建设大道568号
新世界国贸大厦 座49层01室
邮政编码：430000
电话：+86 23 8813 0008
传真：+86 27 8526 7032

厦门

厦门市思明区湖滨东路93号
厦门华润大厦A座1805-2单元
邮政编码：361008
电话：+86 592 2107 298
传真：+86 592 2107 259

西安

西安市高新区唐延路11号
西安国寿金融中心3003单元
邮政编码：710075
电话：+86 29 8114 0201

郑州

郑州市金水东路51号
楷林中心8座5A10
邮政编码：450018
电话：+86 371 8897 3700
传真：+86 371 8897 3710

关于德勤

德勤中国是一家立足本土、连接全球的综合性专业服务机构，由德勤中国的合伙人共同拥有，始终服务于中国改革开放和经济建设的前沿。我们的办公室遍布中国31个城市，现有超过2万名专业人才，向客户提供审计、税务、咨询等全球领先的一站式专业服务。

我们诚信为本，坚守质量，勇于创新，以卓越的专业能力、丰富的行业洞察和智慧的技术解决方案，助力各行各业的客户与合作伙伴把握机遇，应对挑战，实现世界一流的高质量发展目标。

德勤品牌始于1845年，其中文名称“德勤”于1978年启用，寓意“敬德修业，业精于勤”。德勤全球专业网络的成员机构遍布150多个国家或地区，以“因我不同，成就不凡”为宗旨，为资本市场增强公众信任，为客户转型升级赋能，为人才激活迎接未来的能力，为更繁荣的经济、更公平的社会和可持续的世界开拓前行。

Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“德勤组织”）。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为承担责任，而对相互的行为不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅www.deloitte.com/cn/about了解更多信息。

德勤亚太有限公司（一家担保责任有限公司，是境外设立有限责任公司的其中一种形式，成员以其所担保的金额为限对公司承担责任）是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，在亚太地区超过100个城市提供专业服务，包括奥克兰、曼谷、北京、班加罗尔、河内、香港、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、孟买、新德里、大阪、首尔、上海、新加坡、悉尼、台北和东京。

本通讯中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合格的专业顾问。

我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。